

股票代碼:6683



雍智科技股份有限公司

一一三年度 年 報

中華民國一十四年四月十五日刊印

年報刊登相關資訊可至下列網址查詢

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

公司網址 <http://www.ksmt.com.tw>

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人

姓 名：黃榮彬

職 稱：協理

電 話：(03)550-9980#6150

電子郵件信箱：Robin.Huang@ksmt.com.tw

代理發言人

姓 名：林詩堯

職 稱：經理

電 話：(03)550-9980

電子郵件信箱：kevin.lin@ksmt.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：新竹縣竹北市莊敬北路 431 號

電 話：(03)550-9980

分 公 司：無

工 廠：新竹縣竹北市莊敬北路 431 號

電 話：(03)550-9980

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

網 址：<http://www.kgi.com.tw>

電 話：(02)2314-8800

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師：陳重成、陳薔甸會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網 址：www.deloitte.com.tw

電 話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
不適用

六、公司網址 <http://www.ksmt.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書.....	5
貳、公司治理報告.....	7
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	7
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	13
三、公司治理運作情形.....	18
四、會計師公費資訊.....	47
五、更換會計師資訊.....	47
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職 稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	47
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	48
八、持股比例占前十大之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊	49
九、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	49
參、募資情形.....	50
一、資本及股份.....	50
二、公司債辦理情形.....	55
三、特別股辦理情形.....	55
四、海外存託憑證辦理情形.....	55
五、員工認股權憑證辦理情形.....	55
六、限制員工權利新股辦理情形.....	56
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	60
八、資金運用計畫執行情形.....	60
肆、營運概況.....	61
一、業務內容.....	61
二、市場及產銷概況.....	68
三、最近兩年度及截至年報刊印日止從業員工人數	72
四、環保支出資訊.....	72
五、勞資關係.....	73
六、資通安全管理.....	75
七、重要契約.....	76
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	77
一、財務狀況.....	77
二、財務績效.....	77
三、現金流量.....	78
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	79

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	79
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	79
陸、特別記載事項.....	84
一、關係企業相關資料.....	84
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	84
三、其他必要補充說明事項.....	84
柒、最近年度及截至年報刊印日止如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	84

壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

■ 前言

雍智科技期許定位為專注以技術導向的半導體測試服務供應商，尤其在半導體後段晶圓測試載板(Load board 和 Burn-in Board)及對高速射頻 RF 測試載板領域上居於兩岸領先地位之一。2023 年全球半導體景氣循環下滑，中斷公司持續 5 年營收連續成長趨勢。但 2024 年起半導體產業去庫存後景氣逐漸復甦，受惠於手機 AP、電動車及 AIASIC 相關測試需求增加，使公司 2024 年營收創新高。

■ 一一三年度營運結果

2024 年度合併營業額為新台幣 1,736,083 仟元，較去年增加 23.11%；毛利率為 53%較去年上升；營業淨利為新台幣 495,228 仟元，稅後淨利新台幣 479,822 仟元；公司 2024 年整體營運獲利表現突出，稅後基本每股盈餘由去年的 13.07 元上升至 17.69 元，增加 35.35%。稅後淨利增加的成長動能主要來自 2024 年後段晶圓測試載板測試需求增加。在經歷全球新冠肺炎疫情趨緩後，半導體產業整體商品庫存去化調整後，2024 年起景氣開始復甦，加上 AI 技術運用興起，使公司高階規格 IC 測試需求增加，在半導體測試後段晶圓測試載板(Load board 和 Burn-in Board)及前段測試載板（晶圓探針卡測試載板）的營收分別較 2023 年各增加 21%及 33%。

■ 本年度營業計劃概要及未來公司發展策略、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響：

2024 年半導體產業整體商品庫存去化調整後，加上 AI 技術運用興起，使得高階 IC 晶片的需求增加，但成熟製程 IC 晶片需求卻因中美貿易對抗和大陸成熟製程產能不斷增加，導致價格競爭和晶圓廠的成熟晶片產能利用率普遍下滑。2025 年半導體應該會持續這個趨勢。

但雍智科技憑藉在後段晶圓測試載板的電路設計及高速射頻 RF 測試載板領域累積的經驗居於市場領先地位之一，近年逐步拓展業務到老化測試載板(Burn-in Board)及晶圓測試的前段測試載板(晶圓探針卡)領域，本公司審慎樂觀認為 2025 年營運應能夠延續 2024 年的趨勢成長。

2025 年度營業計劃概要及未來公司發展策略：

1. 大陸市場的在地化發展及拓展歐美地區市場

2024 年第四季起，擴大大陸地區的測試載板在地化生產佈局，投入資金建置廠房和機台，提升在後段晶圓測試載板上的競爭力，更能縮短交貨時效性和貼近服務大陸地區的客戶需求，有利爭取更多潛在客戶及建立長期合作關係。另為拓展歐美地區半導體測試載板相關業務，

本公司董事會 2024 年通過設立美國子公司，已逐步開拓美國客戶並帶來實質合作和營收；2025 年大陸及歐美地區營收預期會較 2024 年有所成長。

2. 持續發展前、後段測試載板技術及製程布局

2024 年資本支出主要投入在大陸在地化生產布局上，在老化測試載板領域上持續與客戶深度合作，跨驗多種老化測試平台的設計技術，拉高技術門檻和加深客戶的信任；在前段測試載板(晶圓探針卡)領域上，延續從 2022 年來不斷投入前段測試載板的設備投資及技術暨策略布局，已在 2024 年顯現成效。預期之後會逐年增加前段測試載板(晶圓探針卡)領域的營收空間。

3. 持續優化產線的管理及增加效率

持續提升製造產品的品質及優化自動化生產流程，以因應測試載板設計難度和製程難度的提升，增加客戶對雍智科技在測試載板在交期、可靠度、技術支援滿意度及長期合作的黏著度。

最後，感謝全體員工不斷的技术創新和努力及股東對公司的持續支持。

董事長 李職民



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料：

1.姓名、經(學)歷、持有股份及性質：

114 年 04 月 15 日；單位：股

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別	年 齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時		現在	配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人			備 註
								股數	持 股 比 率		股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			股數	持 股 比 率	職稱	
董事長 (註 1)	中 華 民 國	李職民	男	60	113/6/3	3 年	95/9/6	599,073	2.20%	599,073	935,961	3.42%	3,097,490	11.31%	國立台灣大學電機系碩士 瑞昱半導體(股)公司行銷副總經理	寬遠投資有限公司董事長 KEYSTONE MICROTECH International Ltd 代表人 KSMIT USA CORPORATION 董事	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	劉安炫	男	66	113/6/3	3 年	113/6/3	90,000	0.33%	90,000	-	-	-	-	美國北卡羅萊納州立大學機械工程博士 京元電子(股)公司總經理 KYECS USA Corp. 董事長 KYECS JAPAN K.K. 董事長 KYECS SINGAPORE PTE. LTD 董事長 京隆科技(蘇州)有限公司董事長 蘇州震坤科技有限公司董事長 Intematix Technology Center Corporation 總經理	本公司總經理 KSMIT USA CORPORATION 董事	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	寬遠投資 有限公司	-	-	113/6/3	3 年	106/6/8	3,097,490	11.38%	3,097,490	-	-	-	-	中華大學電機系 榮群電訊工程師 振曜科技工程師 康奈科技工程師	本公司副總 上海芯理科技有限公司監 察人	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	黃淑如	女	51	113/6/3	3 年	113/6/3	292,500	1.07%	292,500	356,464	1.30%	-	-	國立臺北科技大學技術及職業教育研究所博士 國立彰化師範大學商業教育研究所碩士 新北市政府教育局輔導員 新北市立鶯歌高級工商職業學校資料處 理科專任教師兼任校長秘書、學務主任、 總務主任、實習主任 嘉義吳鳳工專專任講師 臺中州立人高中專任教師	本公司董事長暨總經理室 特助	本公司 技術長	盧俊郎	配偶	-
獨立 董事	中 華 民 國	林江亮	男	53	113/6/3	3 年	107/9/28	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學會計學系博士 中原大學總務處總務長 中原大學非營利研究主任 中原大學會計學系主任/教授 美結國際(股)公司獨立董事	東訊(股)公司獨立董事 精拓科技(股)公司獨立董 事	-	-	-	-

114 年 04 月 15 日；單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	年 齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時		現在		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人			備 註
								持有股份 股數	持有股份 比率	持有股份 股數	持有股份 比率	股數	持有股份 比率	股數	持有股份 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中 華 民 國	陳啟文	男	59	113/6/3	3 年	107/9/28	-	-	-	-	-	-	-	-	國立成功大學電機工程學系博士 明新科技大學半導體學院副院長/博士班 主任/電子系主任/教授/內部稽核委員會 主委/教師會常務理事 台灣半導體產業協會產學合作推動小組 召集人 台灣嵌入式單晶片協會理事	-	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	陳金漢	男	59	113/6/3	3 年	110/8/2	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學法律系 漢昇法律事務所執業律師	漢昇法律事務所執業律師 華盛電子(股)公司獨立董 事 新禾新能源(股)公司監察 人	-	-	-	-

註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人說明其原因、合理性、必要性及因應措施；無董事長兼任總經理之情形。

2.法人股東之主要股東：

114 年 04 月 15 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
寬逸投資有限公司	陳綺敏(96.15%)；李職民(3.85%)

3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：不適用。

4.董事所具專業知識及獨立性之情形：

本公司現任董事會成員之專業背景多元化政策落實情形如下：

姓名	職稱	性別	主要現職	兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數	獨董任期年資			專業知識與技能			年齡	
					3 年 以下	3~9 年	9 年 以上	產業 知識	財務 會計	法律/ 經濟	40~60 歲	61~70 歲
李職民	董事長	男	雍智科技董事長					V			V	
劉安炫	董事	男	本公司總經理					V				V
羅文陞	董事之 法人代表人	男	雍智科技副總經理					V			V	
黃淑如	董事	女	本公司董事長暨總經理 室特助					V			V	
林江亮	獨立 董事	男	中原大學會計學系教授 東訊(股)公司獨立董事 精拓科技(股)公司獨立 董事	2		V			V		V	
陳啟文	獨立 董事	男	明新科技大學半導體學 院副院長/博士班主任/ 電子系主任/教授			V		V			V	
陳金漢	獨立 董事	男	漢昇法律事務所執業律 師 華盈電子股份有限公司 獨立董事 新禾新能源(股)公司監 察人	1		V				V	V	

本公司現任董事會成員之獨立性落實情形如下：

姓名	條件	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	專業資格與經驗	獨立性情形
李職民		0	■ 董事專業資格與經驗請參閱本 年報 2.1 董事資 料 (第 7 頁) ■ 本公司所有董 事均未有公司法 第 30 條各款情事 之一。	不適用
劉安炫		0		
羅文陞		0		
黃淑如		0		
林江亮		2		為獨立董事且符合證券交易法 14 條之 2 暨公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法中，所規定之獨立性情形，包含但不限於： ■ 獨立董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義均未持有公司已發行股份，符合董事性要求。 ■ 獨立董事本人近 2 年並無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之報酬情形。
陳啟文		0		
陳金漢		1		

(二)董事會多元化及獨立性：

1.董事會多元化：本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂定董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。

本公司現任董事分別具備經營管理、研發、財務會計、法律及半導體等之專業背景及產業經歷，符合多元化之重要項目。

獨立董事任期目前有二位為第三任期，一位為第二任期。

2.董事會性別平等：

113 年度股東常會改選董事，董事會新增一席女性成員，然因產業特性，合適人才難尋，因而本屆女性董事席次未能達到三分之一。未來朝向董事性別多元化目標邁進。

3.董事會獨立性：

本公司現任董事七席，其中獨立董事三席，獨立董事佔所有董事成員比率 43%。董事採候選人提名制選任，並於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，本公司董事間並無具有配偶或二親等以內之親屬關係情形，獨立董事於執行業務範圍內保持其獨立性，最近 2 年並無提供本公司商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額，並無與公司有直接或間接之利害關係。

(三)總經理、副總經理、協理及各部门主管資料

114 年 04 月 15 日；單位：股

職 稱	姓 名	姓 別	國 籍	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二親 等以內關係之 經理人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
總經理	劉安炫	男	中 華 民 國	112/10/2	90,000	0.33%	-	-	-	-	美國北卡羅萊納州立大學機械工程博士 京元電子(股)公司總經理 KYEK USA Corp. 董事長 KYEK JAPAN K.K. 董事長 KYEK SINGAPORE PTE. LTD. 董事長 京隆科技(蘇州)有限公司董事長 蘇州震坤科技有限公司董事長 Intematix Technology Center Corporation 總經理	KSMT USA CORPORATI ON 董事	-	-	-	-
技術長	盧俊郎	男	中 華 民 國	95/9/19	356,464	1.30%	292,500	1.07%	-	-	國立中山大學電機系碩士 中華電信研究所	KSMT USA CORPORATI ON 董事及代 表人	-	-	-	-
副總經理	羅文陞	男	中 華 民 國	95/11/1	-	-	-	-	-	-	中華大學電機系 榮群電訊工程師 振曜科技工程師 康奈科技工程師	上海芯埕科 技有限公司 監察人	-	-	-	-
副總經理	彭恩德	男	中 華 民 國	96/11/26	-	-	-	-	-	-	University of South Australia MBA 勇頌科技技術支援部經理/業務經理 愛德萬科技客戶工程師	-	-	-	-	-
資深協理	戴育哲	男	中 華 民 國	107/6/1	86,894	0.32%	3,000	0.01%	-	-	國立高雄大學電機所碩士 中華大學電機系學士 台灣福雷電子工程師	-	-	-	-	-
協理	黃榮彬	男	中 華 民 國	105/9/1	55,900	0.20%	-	-	-	-	明新科技大學電子工程系 愛得萬科技工程服務課長 京元電子設備維護課長	上海芯埕科 技有限公司 執行董事及 代表人	-	-	-	-

職 稱	姓 名	姓 別	國 籍	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係之 經理人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
協理	李明義	男	中 華 民 國	100/7/1	2,581	0.01%	12,000	0.04%	-	-	Newport University MBA 邁特電子總經理特別助理 亞帝歐光電董事長特別助理 振曜科技總經理特別助理 友勁科技製造部協理 全友電腦維修組長/採購工程師	-	-	-	-	-
協理	鄭偉中	男	中 華 民 國	96/05/02	79,573	0.29%	27,000	0.10%	-	-	大華技術學院電子工程系 永琛行工程師	-	-	-	-	-
協理	陳浩昇	男	中 華 民 國	107/08/01	36,500	0.13%	-	-	-	-	明新科技大學電子科 利騰國際科技專案經理 力成科技設備副理 GSI 科技工程副理 愛德萬科技客服工程師	-	-	-	-	-
協理	吳興仁	男	中 華 民 國	112/07/01	3,000	0.01%	-	-	-	-	大華技術學院電機系 聯發科技 SA 資深工程師 艾斯普科技 FAE 資深工程師 頤邦科技設備工程師	-	-	-	-	-
財務及會計部門主管	林詩堯	男	中 華 民 國	106/4/5	40,500	0.15%	-	-	-	-	政治大學財政系、財政所 美國密蘇里州立大學哥倫比亞分校 MBA 美時化學財務 controller 緯創資通財務分析專員 鴻佰科技稽核主任	-	-	-	-	-
管理處經理	鍾瑩慧	女	中 華 民 國	95/11/14	35,388	0.13%	-	-	-	-	銘傳大學會計系 世紀民生科技(股)公司資深管理師	-	-	-	-	-
職安室經理	曾俊中	男	中 華 民 國	100/12/01	1,083	0.00%	-	-	-	-	崑山科技大學電子工程系 源鼎科技(股)公司製造部經理	-	-	-	-	-

職 稱	姓 名	姓 別	國 籍	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經（學）歷	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二親 等以內關係之 經理人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
稽核主管	莊郁冷	女	中 華 民 國	104/08/16	10,000	0.04%	-	-	-	-	中原大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所組長	-	-	-	-	-

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)113 年度支付一般董事及獨立董事之酬金之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額		現金金額	
董事長	李職民																	
董事	劉安炫(註1)																	
董事	寬逸投資有限公司代表人-羅文陞(註1)																	
董事	黃淑如(註1)	1,680	1,680	-	-	1,300	180	3,160 0.66%	3,160 0.66%	11,627	11,627	-	5,018	5,018	-	19,805 4.13%	19,805 4.13%	無

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)	兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金				
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)			業務執行費用(D)		退職退休金(F)	員工酬勞(G)							
				本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	現金金額		股票金額	現金金額	股票金額	
董事	盧俊郎(註2)					本公司	財務報告內所有公司										
董事	寬逸投資有限公司代表人-李明義(註2)																
董事	葉啟鴻(註2)																
獨立董事	林江亮																
獨立董事	陳啟文	1,260	1,260	-	-	750	750	135	135	2,145 0.45%	2,145 0.45%	-	-	-	-	2,145 0.45%	2,145 0.45%
獨立董事	陳金漢																無

1.依據本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」，獨立董事及董事執行職務時，不論公司盈虧，得每月支給報酬；另依本公司章程案規定，得由董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值於年度盈餘分配所提撥董事酬勞。114年3月10日董事會通過支付113年董事酬勞金額為新台幣2,050,000元。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

1.依據本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」，獨立董事及董事執行職務時，不論公司盈虧，得每月支給報酬；另依本公司章程案規定，得由董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值於年度盈餘分配所提撥董事酬勞。114年3月10日董事會通過支付113年董事酬勞金額為新台幣2,050,000元。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

(註1) 劉安炫先生及黃淑如女士自民國113年6月3日起擔任本公司董事，羅文陸先生自民國113年6月3日起擔任本公司董事之法人代表人。

(註2) 盧俊郎先生及葉啟鴻先生自民國113年6月3日起卸任本公司董事，李明義先生自民國113年6月3日起卸任本公司董事之法人代表人。上表之資訊僅揭露其擔任本公司董事及董事之法人代表人之終止日為止。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
低於1,000,000 元	李職民、劉安炫、寬逸投資有限公司代表人-羅文陞、黃淑如、盧俊郎、寬逸投資有限公司代表人-李明義、葉啟鴻、林江亮、陳金漢	李職民、劉安炫、寬逸投資有限公司代表人-羅文陞、黃淑如、盧俊郎、寬逸投資有限公司代表人-李明義、葉啟鴻、林江亮、陳金漢	黃淑如、葉啟鴻、林江亮、陳金漢	黃淑如、葉啟鴻、林江亮、陳金漢
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	寬逸投資有限公司代表人-李明義	寬逸投資有限公司代表人-李明義
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	盧俊郎、寬逸投資有限公司代表人-羅文陞	盧俊郎、寬逸投資有限公司代表人-羅文陞
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	李職民、劉安炫	李職民、劉安炫
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	共 10 人	共 10 人	共 10 人	共 10 人

(註) 劉安炫先生及黃淑如女士自民國 113 年 6 月 3 日起擔任本公司董事，羅文陞先生自民國 113 年 6 月 3 日起擔任本公司董事之法人代表人。

盧俊郎先生及葉啟鴻先生自民國 113 年 6 月 3 日起卸任本公司董事，李明義先生自民國 113 年 6 月 3 日起卸任本公司董事之法人代表人。上表之資訊僅揭露其擔任本公司董事及董事之法人代表人之終止日為止。

人之終止日為止。

(二) 113 年度支付監察人之酬金：不適用。

(三)113 年度支付給總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	劉安炫	10,050	10,050	-	-	1,727	1,727	6,112	-	6,112	-	17,889 3.73%	17,889 3.73%	無
技術長	盧俊郎													
副總經理	羅文陞													
副總經理	彭恩德													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	彭恩德	彭恩德
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	盧俊郎、羅文陞	盧俊郎、羅文陞
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	劉安炫	劉安炫
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 4 人	共 4 人

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(四) 113 年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114 年 03 月 10 日董事會通過；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	董事長	李職民	-	15,664	15,664	3.25
	總經理	劉安炫				
	技術長	盧俊郎				
	副總經理	羅文陞				
	副總經理	彭恩德				
	資深協理	戴育哲				
	協理	黃榮彬				
	協理	李明義				
	協理	鄭偉中				
	協理	陳浩昇				
	協理	吳興仁				
	財務及會計部門主管	林詩堯				

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例：

單位：新台幣仟元；%

分析項目	112 年度				113 年度			
	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司	
	酬金總額	占稅後純益(純損)之比例	酬金總額	占稅後純益(純損)之比例	酬金總額	占稅後純益(純損)之比例	酬金總額	占稅後純益(純損)之比例
董事	4,545	1.28	4,545	1.28	5,305	1.11	5,305	1.11
總經理及副總經理	16,460	4.65	16,460	4.65	17,889	3.73	17,889	3.73

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)董事：

本公司董事之報酬，由薪酬委員會審議後，依公司章程規定授權董事會依董事對本公司營運參與程度及公司的營運績效指標議定之；董事盈餘分配酬勞之計算依公司章程規定，本公司年度如有獲利，應以不低於當年度獲利狀況之 10%分派員工酬勞及應以不高當年度獲利狀況之 1%為董事酬勞。董事酬勞分派案應提股東會報告。

(2)總經理及副總經理：

總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工紅利，薪資水準係依對公司所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，所負責事業的營收成長幅度、個人 KPI 指標、年度綜

合機消評估後，由薪酬委員會審議。員工酬勞的分派標準係遵循公司章程，員工酬勞發放之方式得以股票或現金為之，發放之方式、數額及股數應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

依據 113 年度的財務報告，113 年度營業額為新台幣 1,736,083 仟元，較前一年增加 23.11%；稅後淨利新台幣 479,822 仟元，較前一年增加 35.47%；稅後基本每股盈餘由去年的 13.07 元上升至 17.69 元，較前一年增加 35.35%，113 年整體營運獲利表現突出。113 年度董事、總經理及副總經理酬金總額占財務報告稅後純益比例較 112 年度減少，但分別總金額較 112 年度增加。綜上所述，本公司支付董事、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

1.董事會運作情形資訊

本屆董事會任期：113 年 06 月 03 日至 116 年 06 月 02 日，迄今已開會 6 次，最近年度 113 年度及 114 年度截至年報刊印日止董事會共開會 10 次。董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委 託 出 席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	李職民	10	0	100	-
董事	劉安炫	6	0	100	113/6/3 改選就任
董事	寬逸投資有限公司代 表人-羅文陞	6	0	100	113/6/3 改選就任
董事	黃淑如	6	0	100	113/6/3 改選就任
董事	盧俊郎	4	0	100	113/6/3 改選卸任
董事	寬逸投資有限公司代 表人-李明義	4	0	100	113/6/3 改選卸任
董事	葉啟鴻	4	0	100	113/6/3 改選卸任
獨立董事	林江亮	10	0	100	-
獨立董事	陳啟文	10	0	100	-
獨立董事	陳金漢	10	0	100	-

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳下表有關董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)本公司為符合公司治理精神，於 107 年 09 月 28 日自願設置審計委員會，行使證交法、公司法及其他法令之規定之職權。
- (二)本公司於 107 年 04 月 18 日設置薪資報酬委員會，以利負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (三)提升資訊透明度：本公司網站設有「投資人關係」專區，提供發言人信箱，供股東諮詢公司財務、業務相關資訊，並將本公司財務資訊、重大議事決議等資訊均已依規定公佈在公開資訊觀測站，投資大眾均可即時獲得資訊。

2.董事會評鑑執行情形：

雍智科技每年針對董事會整體效能、董事成員績效及功能性委員會運作績效進行自我評估，且將其評估結果提報董事會，作為持續加強董事會運作之參考。111 年 11 月 7 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，以加強董事會運作效能。114 年 3 月 10 日薪酬委員會、審計委員會及董事會對 113 年之自我績效評估的結果得分分別為 93.68%、97.9%與 93.3%。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事成員自評、同儕評估	(1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3) 功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 依本公司審計委員會組織規程第六條規定，審計委員會之職權事項如下：

- (1)、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)、內部控制制度有效性之考核。
- (3)、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)、涉及董事自身利害關係之事項。

- (5)、重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告及須經會計師查核簽證之財務報告。
- (11)、其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 審計委員會運用情形：

本公司於民國 107 年 09 月 28 日設置審計委員會。本公司最近年度 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，審計委員會共召開 9 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	林江亮	9	0	100	-
獨立董事	陳啟文	9	0	100	-
獨立董事	陳金漢	9	0	100	-

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

會議日期	議案內容	溝通結果
113.03.04	112 年第 4 季內部稽核執行情形報告 審閱 112 年內部控制制度聲明書	全體出席獨立董事無意見。
113.05.06	113 年第 1 季內部稽核執行情形報告	全體出席獨立董事無意見。
113.08.05	113 年第 2 季內部稽核執行情形報告	全體出席獨立董事無意見。
113.11.04	113 年第 3 季內部稽核執行情形報告	全體出席獨立董事無意見。
113.12.16	審閱 114 年度稽核計畫	全體出席獨立董事無意見。
114.03.10	113 年第 4 季內部稽核執行情形報告 審閱 113 年內部控制制度聲明書	全體出席獨立董事無意見。

3. 審計委員會年度工作重點彙整及當年度運作情形：

會議日期	議案內容
113.03.04	1.通過 112 年內部控制制度聲明書 2.通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案。 3.通過 113 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 4.通過修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案 5.通過預先核准非確信服務之相關辦法 6.通過檢視超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之是否屬資金貸與性質案 7.通過發行限制員工權利新股案 8.通過透過在 Samoa 的 100%持有子公司 KEYSTONE MICROTECH International Ltd 轉增資大陸地區孫公司上海芯埕科技有限公司案
113.03.15	通過購置土地及廠房案
113.04.09	1.通過辦理 112 年度限制員工權利新股發行及發行辦法修訂案 2.通過提名及審議本公司 113 年股東常會董事/獨立董事候選人案
113.05.06	通過本公司 113 年第 1 季財務報表案
113.06.03	選舉本公司審計委員會召集人暨會議主席案
113.08.05	1.通過 113 年上半年度財務報表案 2.通過檢視超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之是否屬資金貸與性質案
113.11.04	1.通過本公司 113 年第 3 季財務報告案 2.通過檢視超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之是否屬資金貸與性質案 3.通過昌益園區辦公室裝修預算案
113.12.16	1.通過「永續資訊之管理」內部控制制度 2.通過民國 114 年度稽核計畫案
114.03.10	1.通過 113 年內部控制制度聲明書 2.通過檢視超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之是否屬資金貸與性質案 3.通過本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案。 4.通過 114 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 5.通過修訂本公司預先核准非確信服務之相關辦法 6.通過新增資金貸與間接 100%持股的孫公司上海芯埕科技有限公司案 7.通過民國一一三年度盈餘分配案

4. 監察人參與董事會運作情形：不適用。

本公司於 107 年 9 月 28 日股東臨時會改選，設置審計委員會代替監察人職權。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定公司治理實務守則，並揭露於公司網站。 無重大差異
二、公司股權結構及股東權益			
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 公司設有發言人及代理發言人負責處理相關事宜。 無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 由專業的股務代理機構負責。並設有股務人員處理相關事宜。 無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司已制定「關係人相互間財務業務相關作業規範」等具體書面財務業務作業辦法，以規範與關係企業間之往來事項。 無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有防範內線交易之管理辦法。113年共190人參加內線交易法規介紹教育訓練並完成確認簽核。 無重大差異
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司董事會成員均在各領域有所專長，如財務會計、半導體產學、法律專才，就公司部門營運提出卓見和監督。 無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 公司分別於107年04月18日及107年9月28日設置薪資報酬委員會及審計委員會，且於113年8月5日成立「永續發展暨風險管理委員會」，將來視實際需要斟酌辦理。 無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司尚未制度，但已經依相關作業執行並提報董事會。 無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司董事會每年均進行對會計師適任性及獨立性之評估。參酌審計品質指標(AQIs)及會計師法第 47 條及中華民國會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」訂定本公司之會計師適任性及獨立性評估表。113年3月4日及114年3月10日董事會經評估後，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認簽證會計師符合獨立性，出具之財務報告之可信賴度無虞。 無重大差異

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	是 否	
續三、(四)			評估項目		同上
			1.非為公司或關係企業之受僱人。	■	
			2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。	■	
			3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	■	
			4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	■	
			5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。	■	
			6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。	■	
			7.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	■	
			8.未有公司法第30條各款情事之一。	■	
			9.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	■	
			10.最近二年內不得擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	■	
			11.不得涉及本公司制定決策之管理職能。	■	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		本公司已在111年3月7日董事會通過設置公司治理主管，由財會主管兼任，作為公司治理單位，負責公司治理相關事務。包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料。		無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		設有利害關係人聯絡專員處理相關事宜，並於公司網站提供聯絡方式。		
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		公司委任專業股務代辦機構辦理。		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V		無重大差異 無重大差異 無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。公司持續強化財務業務及公司治理相關資訊於公司網站之揭露，提升公司治理品質，以強化公司之競爭力。			

(四)薪酬委員會其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

114 年 04 月 15 日

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事	林江亮	請參閱：			2	-
	陳啟文	二、4.董事所具專業知識及獨立性之情形中			-	-
	陳金漢				1	-

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)薪資報酬委員會職責：

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

A.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬及配合物價指數之變動與營運獲利情況，評估上述對象薪資之調整。

(3)本屆委員任期：113 年 6 月 3 日至 116 年 6 月 2 日，最近年度 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會共開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人	林江亮	4	0	100%	-
委員	陳啟文	4	0	100%	-
委員	陳金漢	4	0	100%	-
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。					

(4) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

會議日期	議案內容	決議結果
113.03.04	審議 112 年度員工(含經理人)酬勞及董事酬勞分配案	經全體出席委員同意通過。
113.04.09	審議 112 年度限制員工權利新股發行及發行辦法修訂案	經全體出席委員同意通過。
113.12.16	審議 113 年度經理人年終獎金及酬勞分配案	經全體出席委員同意通過。
114.03.10	審議 113 年度員工(含經理人)酬勞及董事酬勞分配案	經全體出席委員同意通過。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	本公司永續發展管理現由財務處兼任管理單位且已於113年8月5日成立「永續發展暨風險管理委員會」，委員會下具有負責「公司治理」、「環境永續」、「夥伴關係」及「員工及社會影響」工作小組，由相關權責部門執行，經由不定期會議及依議題而設置之工作小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方案，同針、規劃及執行各組織與永續發展相關方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 永續發展暨風險管理委員會每年一次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃，由董事會檢視各項策略的進展以敦促經營團隊進行調整。	未來年度規劃之策略及目標擬向董事會報告執行情形。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司113年以 GRI 2021 準則 (GRI Standards) -「GRI 3：重大主題 2021」為基礎與參考 IFRS 永續揭露準則及歐洲永續發展報告準則 (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) 之「雙重重大性 (Double Materiality)」原則，將永續衝擊納入影響重大性 (Impact Materiality) 及財務重大性

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(Financial Materiality)，建構重大性分析方法，透過5大步驟決定重大永續議題：(1)了解組織脈絡(2)鑑別對外衝擊(3)鑑別對內衝擊(4)排序議題衝擊的顯著程度(5)決定重大性永續議題。113年永續議題風險評估範疇以評估本公司營運活動在各項永續層面對社會、環境、人羣(含人權)之影響性衝擊(外部衝擊)，以及外部衝擊造成本公司須因應該衝擊而投入資源進行管理之財務性衝擊(內部衝擊)，權衡內外外部衝擊產出永續衝擊分析結果，經由相關權責部門討論後，確認納入永續報告書揭露之重大議題共6項，114年2月永續衝擊分析之結果經與高階主管確認。持續研擬永續目標與據以落實，採取相對應之必要措施，期以降低相關永續風險之影響。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司產業特性屬半導體封裝測試之一環，主要從事各類IC測試載板之供應商，遵守各項環保及相關規定。雍智科技秉持環境友善理念，致力於日常營運中落實節能減碳，降低企業經營對自然環境之衝擊。本公司自112年取得ISO 14001環境管理系統，透過決定重大環境考量面、合規義務、風險及機會，更有效的系統化進行環境管理。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		1.本公司營運活動之能源使用，主要為新竹總部廠辦之公用設備、空壓機、冷卻水塔、冰水主機等設備，	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？		包含燃料(柴油、車用汽油)使用與廠辦電力耗用，最主要能源使用以廠辦電力為大宗。然而，本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之辦公設備，降低企業能源消耗，使能源使用效率最佳化。 此外，本公司為響應政府綠能政策，亦提早因應氣候相關風險，目前於辦公大樓5樓露台設置太陽能發電系統達發電量30 kW。未來預計評估頂樓擴大太陽能發電之可行性，預計若未來完成建置總發電量可達66 kW。 2.本公司依據各國法規及客戶要求，建立化學品資料，重點包含資料收集、法規符合、儲存考量、防護設計、緊急應變，有足夠且完整的預防資訊方能盡量避免災害發生，已於112年完成「化學品管理辦法」制定，強化化學品管理機制，降低環境衝擊。 惟本公司屬於屬於半導體供應鏈中IC (Integrated Circuit) 測試產業，主要專注於半導體測試載板的設計與後段組裝製造，購買之大宗的原材料為PCB板材，購置時已為成品，現行PCB板材採用再生材料比例極低，但本公司呈持續關注未來PCB板材採用再生材料之可能性，以降低環境負荷與衝擊。	無重大差異
	V	1.本公司為於半導體供應鏈中IC (Integrated Circuit) 測試產業，產業供應鏈位居中游與下游，所面臨氣候變遷的潛在風險在於溫室效應的影響下所產生的天然災害，導致限水限電、供應鏈中斷、原物料成本	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		上升等，可能對公司營運產生衝擊而增加損失風險。另一方面氣候變遷也可能也為公司業務發展帶來新的契機，使用更高效率的生產和配銷流程，透過如於低碳轉型過程，透過生產效率提升、能源設備汰換、智慧控制等措施，將可達到節能減碳效益，在未來能源成本提高、綠色通膨的預期環境下，將能有效降低衝擊。 2.本公司為因應全球氣候變遷並接軌國際低碳趨勢，自2023年首次參考金融穩定委員會氣候相關財務資訊揭露工作小組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)於2017年6月發佈之「氣候相關財務揭露建議(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」啟動氣候變遷相關風險與機會評估作業，以制定管理方針及規畫因應措施。此外，為因應永續及氣候相關財務揭露，提前盤點現行氣候管理與國際財務報導準則第S2號「氣候相關揭露」之差異，掌握氣候變遷對其未來營運之影響，並納入財務規劃考量。	無重大差異
	V	本公司為IC(Integrated Circuit)測試產業，從事半導體測試載板的設計與後段組裝製造，為環境友善理念，致力於日常營運中落實節能減碳，降低企業經營對自然環境之衝擊。針對能源管理，於總部辦公大樓實施空調與照明之節電措施，進	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因																																								
	是	否																																									
		摘要說明 而降低溫室氣體排放。水資源管理部份，於製程起純水產生之廢水、空調冷凝水均進行回收作為總部生活用水沖廁或澆灌等利用。廢棄物管理部分，針對一般廢棄物，於平日落實及宣導垃圾分類、回收，盡可能降低一般廢棄物產生；此外，事業廢棄物主要為報廢電路板、有機溶劑等，每年委託具備甲級處理許可證之廠商清運處理。 1. 溫室氣體排放量 <table><tr><th>溫室氣體排放量 (單位：噸-CO₂e)</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>69.3778</td><td>61.2866</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>907.6523</td><td>957.4232</td></tr><tr><td>總計</td><td>977.0301</td><td>1,018.7098</td></tr><tr><td>溫室氣體排放密集度 (噸-CO₂e／百萬營收)</td><td>0.6929</td><td>0.5869</td></tr></table> 2. 用水量 <table><tr><th>淡水-第三方用水</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>取水量統計</td><td>6.78</td><td>8.10</td></tr><tr><td>單位取水強度 (ML／百萬營收)</td><td>0.0048</td><td>0.0047</td></tr></table> 單位：百萬公升 (Megaliters, ML) 3. 廢棄物總重量 <table><tr><th colspan="2">回收再利用</th><th colspan="2">直接處置</th></tr><tr><th>有害</th><th>非有害</th><th>總重量</th><th>總重量</th></tr><tr><td>112年</td><td>0</td><td>0.17</td><td>2.07</td></tr><tr><td>113年</td><td>0</td><td>0.20</td><td>1.17</td></tr></table>	溫室氣體排放量 (單位：噸-CO ₂ e)	112年	113年	範疇一	69.3778	61.2866	範疇二	907.6523	957.4232	總計	977.0301	1,018.7098	溫室氣體排放密集度 (噸-CO ₂ e／百萬營收)	0.6929	0.5869	淡水-第三方用水	112年	113年	取水量統計	6.78	8.10	單位取水強度 (ML／百萬營收)	0.0048	0.0047	回收再利用		直接處置		有害	非有害	總重量	總重量	112年	0	0.17	2.07	113年	0	0.20	1.17	
溫室氣體排放量 (單位：噸-CO ₂ e)	112年	113年																																									
範疇一	69.3778	61.2866																																									
範疇二	907.6523	957.4232																																									
總計	977.0301	1,018.7098																																									
溫室氣體排放密集度 (噸-CO ₂ e／百萬營收)	0.6929	0.5869																																									
淡水-第三方用水	112年	113年																																									
取水量統計	6.78	8.10																																									
單位取水強度 (ML／百萬營收)	0.0048	0.0047																																									
回收再利用		直接處置																																									
有害	非有害	總重量	總重量																																								
112年	0	0.17	2.07																																								
113年	0	0.20	1.17																																								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		為提供平等與健康之工作環境，於雇用方面禁止任何歧視行為，不因員工之種族、年齡、性別、性傾向、殘疾、懷孕、政治、宗教而有所歧視，本公司依據聯合國世界人權宣言、國際勞工組織的工作基本原則與權利宣言，制定雍智科技「人權政策與管理辦法」辦法中明訂如不得禁止工作者 集會結社自由、不雇用童工及不強迫勞動等規定，以保障其工作者之基本人權。在臺灣地區若遇特殊狀況須與員工終止勞動契約，則依照勞動基準法進行資遣預告及後續相關資遣費支付。113年度未有強制勞動之情事發生，亦無與人權及強制性勞動有關之申訴案件。	無重大差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		1.本公司福利涵蓋健康、生活、節慶、保險等面向，提供員工所需之福利項目。除了依據政府法令為每位員工投保勞工保險及全民健康保險外，亦為每位員工全額負擔團體保險費用，保障內容涵蓋壽險、意外傷害險、醫療險及癌症險等。讓員工在發生意外或傷病時，能享有完善的醫療照顧、撫卹及經濟上之保障。員工亦可以優惠的保險費率，為家人投保公司的團體保險，讓眷屬也能同樣享有公司提供的保障。針對海外出差同仁，均主動投保高額的旅行平安險，以提供同仁更充分的保障。 2.自2005年7月1日勞工退休金條例實施後，本公司全	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
			體員工皆適用新制。公司每月依員工薪資6%提撥至勞工保險局之個人退休金帳戶，及依員工意願協助配合自願提繳作業。 3. 雍智科技設置職工福利委員會，由各部门推派代表所組成，負責統籌、規畫及執行公司各項福利措施，期提供員工良好的工作環境與兼顧員工的身心健康，進而達成工作與生活平衡的目標。 4. 依照本公司內控制度薪資管理辦法作業，視公司營運情形及員工個人績效表現調整薪酬給付及個人升遷。此外，本公司2024年發行限制員工權利新股（經董事會決議發行）獎勵員工未來表現，期待與本公司共同成长。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			檢查，並於每年舉辦消防安檢、消防講習及演練、加強員工工作安全之教育訓練與宣導。 2.113年無任何職業傷害事件，失能傷害頻率(FR)、失能傷害嚴重率(SR)均為0。全體員工與承攬商皆無工傷或職業病等情事，亦無違反違反勞基法或職安法相關規定遭受處分情事。 3.113年導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，系統化地推行職業安全衛生管理工作。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		公司與供應商合作共同致力推動環保方向，遵守各項政策以善盡企業社會責任。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司編制企業永續報告書，依循全球報告倡議組織（The Global Reporting Initiative, GRI）由全球永續性標準委員會（Global sustainability standard board, GSSB）發布之GRI永續報告準則（GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards），同時依據永續會計準則（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）之科技與通訊（Technology and Communications）領域的半導體（Semiconductors）產業標準所撰寫。前揭報告書尚未取得第三方驗證單位查證。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：不適用。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 參與社會公益：本公司公益捐獻範疇，包含地區廟宇、地區教會、慈善社會公益機構的愛心捐款，113年及112年分別約為新台幣183萬及173萬元。未來除了持續針對社區型服務機構及社會公益機構捐助外，鼓勵員工投入社區服務。				

(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

推動項目	執行情形								
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為本公司氣候變遷相關議題最高決策單位，指導與監督氣候相關風險與機會的因應情形。本公司為強化永續與氣候相關風險管理，已於 113 年於董事會下設置功能性委員會-「風險暨永續發展委員會」，負責永續與氣候變遷風險管理相關議題。 <table border="1" data-bbox="528 168 855 1664"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1261 572 1664">治理單位</th><th data-bbox="528 168 572 1261">權責</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 1261 617 1664">董事會</td><td data-bbox="572 168 617 1261">指導氣候變遷風險管理成效。</td></tr> <tr> <td data-bbox="617 1261 735 1664">永續發展暨風險管理委員會</td><td data-bbox="617 168 735 1261">負責擬定推動永續發展及風險管理之政策，以及審核永續發展相關議題之政策、管理方針及具體推動計畫並對於執行情形與成效進行檢討與追蹤。每年至少召開 1 次會議，並向董事會報告。</td></tr> <tr> <td data-bbox="735 1261 855 1664">財務處兼任管理單位</td><td data-bbox="735 168 855 1261">推動氣候變遷風險與機會管理，協助彙整鑑別風險與機會、規劃與執行因應方案。每年至少一次，透過永續發展暨風險管理委員會向董事會報告氣候管理相關執行成效。</td></tr> </tbody> </table>	治理單位	權責	董事會	指導氣候變遷風險管理成效。	永續發展暨風險管理委員會	負責擬定推動永續發展及風險管理之政策，以及審核永續發展相關議題之政策、管理方針及具體推動計畫並對於執行情形與成效進行檢討與追蹤。每年至少召開 1 次會議，並向董事會報告。	財務處兼任管理單位	推動氣候變遷風險與機會管理，協助彙整鑑別風險與機會、規劃與執行因應方案。每年至少一次，透過永續發展暨風險管理委員會向董事會報告氣候管理相關執行成效。
治理單位	權責								
董事會	指導氣候變遷風險管理成效。								
永續發展暨風險管理委員會	負責擬定推動永續發展及風險管理之政策，以及審核永續發展相關議題之政策、管理方針及具體推動計畫並對於執行情形與成效進行檢討與追蹤。每年至少召開 1 次會議，並向董事會報告。								
財務處兼任管理單位	推動氣候變遷風險與機會管理，協助彙整鑑別風險與機會、規劃與執行因應方案。每年至少一次，透過永續發展暨風險管理委員會向董事會報告氣候管理相關執行成效。								
二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司於 112 年進行氣候風險與機會鑑別與評估，排序結果可歸納出短、中、長期可能帶來衝擊的主要風險與機會因子，經過內外部討論，彙整 4 項主要風險與 5 項可能機會。整體而言，短期內雍智於氣候變遷影響下並無高度衝擊的風險，而長期趨勢下，機會可能帶來的效益則相對較為顯著。此外本公司規劃每二至三年重新執行鑑別與評估作業，每年檢視執行狀況與檢討目標計畫。								

轉型機會	機會描述	財務衝擊	衝擊對象	實現機會的方式
建立新興風險管理架構	未來 IFRS 永續揭露標準則將以 TCFD 四大支柱為基礎，分別為：治理、策略、風險管理及指標與目標進行揭露要求。提前建立完善的企業風險管理(ERM)制度除了能符合未來法規要求，更能提供一致、可比較及高品質之永續報導，以符合投資者的需求。	短期 (0-1 年) 符合未來法規要求	直接營運	已於 113 年成「風險暨永續發展委員會」
使用更高效率的生產和配銷流程	於低碳轉型過程，透過生產效率提升、能源設備汰換、智慧控制等措施，將可達到節能減碳效益，在未來能源成本提高、綠色通膨的預期環境下，將能有效降低衝擊。	長期 (5-10 年) 降低營運成本	直接營運	雍智非能源大戶，目前主要能源設備皆為變頻。辦公室則採取中午關燈一小時、全面採用 LED 燈等措施達到節能目的。
轉用更高效率的建築物	「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略」規劃 2050 年 100%新建建築物及超過 85%既有建築物為近零碳建築之目標。針對新建建築先採取鼓勵方式，再逐步修訂法規強制實施。提前採用綠建築除有相關補助方案，亦能提升企業形象、降低能源成本。	長期 (5-10 年) 降低營運成本	直接營運	未來若建置新廠，可評估導入綠建築設計之效益。
創新燃料及再生能源	能源轉型為達到淨零目標的首要關鍵條件，唯透過提升能源效率及結構轉型、增加零碳能源（如：再生能源、氫能等）供給，逐步降低對化石能源依賴，以促使能源與電力供給結構轉向低碳無碳化。	長期 (5-10 年) 降低營運成本	直接營運	目前已有太陽能發電設備，但發電量售予台電公司。未來持續評估增加自發自用再生能源之效益。

推動項目	執行情形				
	企業營運可持續性及危機管理	氣候變遷是一個長期變化的過程，與自然環境及社會經濟交互影響的複雜程度，為企業對於風險的預測充滿帶來更多不確定性。營運持續管理（business continuity management, BCM）可系統性來管理風險，加強對未來營運中斷的復原力。	長期（5-10 年）降低直接及間接成本	直接營運	目前已有缺水、地震、風災、消防等緊急應變計畫，未來可評估導入 BCM 之可行性。
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	顯著風險 轉型風險： 報導要求趨嚴，揭露要求增加	影響層面 自身營運	潛在財務衝擊 長期（5-10 年）增加直接成本	說明 金管會於 2022 年 8 月時宣布 2024 年起上市櫃公司須於年報中揭露氣候變遷對公司財務影響、公司治理態度、及風險評估等九大資訊，其中也包含四個氣候假設情境，以及盤查溫室氣體。並於 2023 年 8 月正式發布我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖，進一步接軌國際準則。未來將以直接採用(adopton)方式接軌 IFRS 永續揭露準則。	
	短期實體風險： 夏季極端高溫影響供電穩定，造成突發性斷電	自身營運	短期（0-1 年）增加直接成本與資本支出	《臺灣氣候變遷科學報告 2017》針對臺灣的極端高溫進行研究，在暖化程度接近 RCP6.0 的 AIB 情境下，21 世紀末臺灣極端高溫日數及溫度皆可能增加，在極端高溫日數方面，全台可能增加超過 90 天。極端高溫衝擊若為突發性斷電，則將導致生產暫時中斷。	
	短期實體風險： 風災（颱風減少強度增加） 長期實體風險： 極端氣候型態增加	自身營運 自身營運	短期（0-1 年）增加間接成本 長期（5-10 年）增加直接成本及資本支出	依據科技部台灣氣候模擬系統發展團隊研究顯示，未來西北太平洋颱風發生次數顯著減少，但強度及雨量明顯增強，侵台的颱風頻率也顯著減少，雖對全年總雨量貢獻降低，但颱風的強度及雨量顯著增加。淹水可能影響員工上下班通勤，及地下室之基礎設施（如空壓機等）。 《臺灣氣候變遷科學報告 2017》推估臺灣未來溫度的變化，增溫將可能超過攝氏 1 度。不論是 RCP4.5 或 RCP 8.5，臺灣北區都將是增溫幅度最明顯的區域。未來降雨可能呈現「豐越豐、枯越枯」的情形。	

推動項目	執行情形		
			依據依據國家災害防救中心模擬，在暖化程度接近 RCP4.0 情境下，竹北暴露於淹水危害的風險等級將由第四級升高至風險等級最高之第五級。竹北暴露於乾旱危害的風險等級到世紀末將由第一級升高至風險等級最高之第四級。
四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	風險與機會辨識	參考 TCFD 建議、產業相關資訊與內外外部討論，初步評估與本公司相關的風險與機會因子	邀集相關部門進行風險與機會評估，並針對評估結果與內外外部確認與討論，確認相關風險因子的影響、可能發生的時間區間與可能的財務衝擊。
	風險與機會評估		針對鑑別出之顯著潛在風險與可能機會，考量公司既有營運發展方向，由相關部門進行因應方案規劃，於規劃未來定期的「風險暨永續發展委員會」會議中確認與報告。
	因應規劃		相關執行成果於經營管理會議中追蹤與報告。
	監督與報告	本公司預計風險管理議題將規劃未來定期於「風險暨永續發展委員會」中識別、確認與規劃因應方式，現納入氣候變遷相關因子，仍於「風險暨永續發展委員會」會議中確認與報告，已納入既有風險管理制度中。	本公司考量國際評估報告與國內相關政策法規，設定氣候風險與機會評估情境，轉型風險主要考量 2050 淨零排放情境，實體風險主要考量 RCP4.0-8.5 情境。(詳見推動項目三回應內容)
五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。			
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。		金管會於 111 年 8 月時宣布 113 年起上市櫃公司須於年報中揭露氣候變遷對公司財務影響、公司治理態度、及風險評估等九大資訊，其中也包含四個氣候假設情境，以及盤查溫室氣體。未來更將進一步接軌國際準則，以直接採用方式接軌 IFRS 永續揭露準則。低碳轉型過程，勢必將受到更嚴謹的法規政策及能源成本提高之影響，連帶提升製造成本。	雍智非高度能源密集用戶，但以外購電力為主要能源使用，未來將以節電為主要目標來降低溫室氣體的排放密集程度，現已著手執行溫室氣體盤查，以有效監測溫室氣體排放量。 隨著低碳社會的轉型，未來對於創新低碳技術的需求亦將帶來更多可能性，除已知的風險及機會外，雍智亦將持續關注低碳技術趨勢、政府獎勵計劃等，以創造更多機會。因此，雍智已於 113 年成立風險管理組織架構，系統性識別包括氣候變遷等相關風險與機會，以進一步管理潛在之實體風險及實現轉型機會。

推動項目	執行情形
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	無。
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	本公司目前溫室氣體自主盤查，待 115 年執行 114 年溫室氣體經外部查證後，規劃近一步制定減量目標、策略及具體行動計畫。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露之資料涵蓋範圍： 1. 母公司(雍智科技)個體應自民國 114 年開始盤查。 2. 合併財務報告子公司應自民國 115 年開始盤查。

溫室氣體盤查情形

雅智科技 (新竹總部)	113 年		112 年	
	範疇	排放量 (公噸 CO ₂ e)	排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/營業額新臺幣 百萬元)
	範疇一	61.2866	69.3778	-
	範疇二	957.4232	907.6523	-
	總計	1,018.7098	977.0301	0.6929

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
112 年溫室氣體盤查仍為自主自願性盤查，無經外部確信。
依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應執行確信之涵蓋範圍：
1. 母公司個體應自民國 116 年開始執行確信。
2. 合併財務報告子公司應自民國 117 年開始執行確信。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
尚未訂定減量基準年及相關減碳方案。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」並由財務處(公司治理主管兼任)負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。 (二) 本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」提供為公司經營重要事務人員的行為規範，內部稽核人員並定期查核，並於「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。 (三) 本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」，明定相關作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。本公司訂有完善的違規懲戒及申訴制度，且落實於公司網站設置「利害關係人聯絡窗口」專頁。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其	V	V	(一) 本公司對往來之客戶及供應商均有評核機制，訂立合約時，對雙方的權利義務均詳訂其中並保密。 (二) 本公司推動企業誠信經營專責單位為財務處(由公司治理主管兼任)，負責推動誠信經營	無重大差異 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？			政策及規範之制訂、執行與監督。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司設有人資及稽核單位，可提供檢舉人檢舉的陳述管道並對檢舉人身份及內容應保密。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四)本公司訂定有內部稽核計畫，內部稽核單位均依稽核計畫執行各項查核作業。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)113年已執行誠信經營宣導教育訓練並簽署完成207份(佔台灣員工總數的73%)。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？		V	(一)本公司已設有利害關係人聯絡窗口及不當行為舉報之檢舉及申訴信箱，並在公司網路上公告。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？		V	(二)公司受理檢舉後，將由公司治理主管辦理調查作業，並適時通告獨立董事。	無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？		V	(三)公司受理後嚴格保密、調查處理所有舉報資料，並採取特別措施以保護舉報人個資。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司依相關法規揭露各項相關資訊於公開資訊觀測站外，並於公司網站揭露誠信經營守則內容。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書：請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

公開資訊觀測站→單一公司→公司治理→公司規章/內部控制>內控聲明書公告(公司代號:6683)查詢

2.會計師專案審查內部控制制度報告:無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1.股東會重要決議事項及執行情形：

會議日期	重要議案摘要	執行情形
113.06.03 (股東常會)	承認事項 1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。 2. 一一三年度盈餘分配案。 討論事項 1. 通過發行限制員工權利新股案。 選舉事項: 董事全面改選。 其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	相關之盈餘已於113年8月01日全數分派完畢(每股分配現金股利6.50922419元)。 已選任4名董事和3名獨立董事並公告。

2.董事會重要決議事項

會議日期	重要議案摘要
113.03.04	1.通過 112 年內部控制制度聲明書 2.通過本公司 112 年度員工(含經理人)酬勞及董事酬勞分配案 3.通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案 4.通過民國一一二年度盈餘分配案 5.通過修訂本公司之「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案 6.通過制定本公司預先核准非確信服務之相關辦法 7.通過 113 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 8.通過檢視本公司超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之非屬資金貸與性質案 9.通過限制員工權利股票收回註銷基準日訂定案 10.通過發行限制員工權利新股案 11.通過透過在 Samoa 的 100%持有子公司 KEYSTONE MICROTECH International Ltd 轉增資大陸地區孫公司上海芯埕科技有限公司案 12.通過本公司董事全面改選案 13.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 14.通過本公司召開 113 年股東常會案
113.03.15	通過購置土地及廠房案

會議日期	重要議案摘要
113.04.09	1.通過辦理 112 年度限制員工權利新股發行及發行辦法修訂案 2.通過提名及審議本公司 113 年股東常會董事/獨立董事候選人案
113.05.06	通過本公司 113 年第 1 季財務報告案
113.06.03	1.通過董事長選任案 2.通過聘任薪資報酬委員案
113.06.24	通過訂定分派現金股利除息基準日案
113.08.05	1.通過本公司 113 年第 2 季財務報告案 2.通過檢視本公司超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之非屬資金貸與性質案 3.通過本公司限制員工權利股票收回註銷基準日訂定案 4.通過訂定「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案 5.通過成立永續發展暨風險管理委員會並委任委員會成員案 6.通過本公司 2023 年永續報告書暨通過「2024 年永續目標」案
113.11.04	1.通過本公司 113 年第 3 季財務報告案 2.通過檢視本公司超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之非屬資金貸與性質案 3.通過追認出售機器設備一批予關係人芯埕科技股份有限公司案 4.通過昌益園區辦公室裝修預算案
113.12.16	1.通過本公司 113 年度經理人年終獎金及酬勞分配案 2.通過「永續資訊之管理」內部控制制度 3.通過民國 114 年度稽核計畫案 4.通過 114 年度預算編列案 5.通過訂定關係人相互間財務業務相關作業規範
114.03.10	1.通過本公司 113 年內部控制制度聲明書 2.通過本公司 113 年度員工(含經理人)酬勞及董事酬勞分配案 3.通過檢視本公司超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之非屬資金貸與性質案 4.通過本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案 5.通過本公司民國一一三年度盈餘分配案 6.通過本公司 114 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 7.通過修訂本公司預先核准非確信服務之相關辦法 8.通過修訂本公司「公司章程」案 9.通過新增資金貸與間接 100%持股的孫公司上海芯埕科技有限公司案 10.通過本公司召開 114 年股東常會案

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師資訊:

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳重成	陳蕃旬	112 年度	
勤業眾信聯合會計師事務所	陳重成	陳蕃旬	113 年度	

(二) 會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳重成 陳蕃旬	112 年度	3,300	212 (註 1)	3,512	註1: 稅務簽證200；子公司 COI 文件 12
勤業眾信聯合會計師事務所	陳重成 陳蕃旬	113 年度	3,300	520 (註 2)	3,820	註2: 稅務簽證200；辦理發行限制員工權利新股 320

(三) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(四) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊:

無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：
無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年		114 年 截至 04 月 11 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼大股東	李職民	-	-	-	-
董事兼總經理	劉安炫	-	-	-	-
董事兼技術長	盧俊郎(註 1)	(2,000)	-	(4,000)	-
董事	黃淑如				
董事	寬逸投資有限公司 代表人-羅文陞				
董事	寬逸投資有限公司 代表人-李明義(註 1)	-	-	-	-
董事	葉啟鴻(註 1)	(30,000)	-	-	-
獨立董事	林江亮	-	-	-	-
獨立董事	陳啟文	-	-	-	-
獨立董事	陳金漢	-	-	-	-
副總經理	羅文陞	-	-	-	-
副總經理	彭恩德	-	-	-	-
協理	李明義	(58,000)	-	-	-
資深協理	戴育哲	(8,000)	-	(6,000)	-
協理	陳浩昇	-	-	-	-
協理	鄭偉中	-	-	-	-
協理	黃榮彬	1,000	-	-	-
協理	吳興仁	-	-	-	-
會計主管	林詩堯			(2,000)	

註 1：盧俊郎先生及葉啟鴻先生自民國 113 年 6 月 3 日起卸任本公司董事，李明義先生自民國 113 年 6 月 3 日起卸任本公司董事之法人代表人。上表之資訊僅揭露其擔任本公司董事及董事之法人代表人之終止日為止。

(二)股權移轉之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得股數：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十大之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年04月11日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
寬逸投資有限公司	3,097,490	11.31%	-	-	-	-	李職民	為該公司代表人	-
寬逸投資有限公司負責人：李職民	599,073	2.19%	935,961	3.42%	-	-	寬逸投資有限公司	為該公司代表人	-
							陳綺敏	配偶	-
陳綺敏	935,961	3.42%	599,073	2.19%	-	-	李職民	配偶	-
花旗託管波寧新基金專戶	741,654	2.71%	-	-	-	-	-	-	-
李職民	599,073	2.19%	935,961	3.42%	-	-	寬逸投資有限公司	為該公司代表人	-
							陳綺敏	配偶	-
慧榮投資股份有限公司	571,717	2.09%	-	-	-	-	-	-	-
慧榮投資股份有限公司代表人：黃榮輝	10,884	0.04%	-	-	-	-	-	-	-
大通託管JP摩根證券投資專戶	507,000	1.85%	-	-	-	-	-	-	-
張晉璋	494,000	1.80%	-	-	-	-	-	-	-
新制勞工退休基金	411,000	1.50%	-	-	-	-	-	-	-
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	372,000	1.36%	-	-	-	-	-	-	-
盧俊郎	356,464	1.30%	292,500	1.07%	-	-	-	-	-

九、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

截至 114 年 4 月 15 日止，並無公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

114 年 04 月 15 日；單位：股；新台幣元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他
95/09	10	7,500,000	75,000,000	6,350,000	63,500,000	設立股本	無	註 1
99/05	10	7,500,000	75,000,000	7,400,000	74,000,000	現金增資 10,500,000 元	無	註 2
99/11	10	10,000,000	100,000,000	8,140,000	81,400,000	盈餘轉增資 7,400,000 元	無	註 3
100/11	10	10,000,000	100,000,000	9,930,800	99,308,000	盈餘轉增資 17,908,000 元	無	註 4
101/11	10	15,000,000	150,000,000	10,896,080	108,960,800	盈餘轉增資 9,652,800 元	無	註 5
102/09	10	15,000,000	150,000,000	11,960,888	119,608,880	盈餘轉增資 10,648,080 元	無	註 6
103/12	10	20,000,000	200,000,000	16,691,642	166,916,420	盈餘轉增資 47,307,540 元	無	註 7
104/10	10	20,000,000	200,000,000	19,175,290	191,752,900	盈餘轉增資 24,836,480 元	無	註 8
105/10	10	36,000,000	360,000,000	21,079,419	210,794,190	盈餘轉增資 19,041,290 元	無	註 9
106/02	10	36,000,000	360,000,000	21,022,419	210,224,190	庫藏股註銷 570,000 元	無	註 10
106/08	10	36,000,000	360,000,000	23,124,661	231,246,610	盈餘轉增資 21,022,420 元	無	註 11
106/12	36	36,000,000	360,000,000	24,624,661	246,246,610	員工認股權憑 證換發新股 15,000,000 元	無	註 12
108/04	75	36,000,000	360,000,000	27,075,661	270,756,610	初次上櫃現金 增資 24,510,000 元	無	註 13
111/08	0	36,000,000	360,000,000	27,225,661	272,256,610	發行無償限制 員工權利新股 150,000 股	無	註 14
112/08	0	36,000,000	360,000,000	27,217,661	272,176,610	註銷限制員工 權利新股 8,000 股	無	註 15
113/03	0	36,000,000	360,000,000	27,209,661	272,096,610	註銷限制員工 權利新股 8,000 股	無	註 16
113/05	0	36,000,000	360,000,000	27,389,661	273,896,610	發行無償限制 員工權利新股 180,000 股	無	註 17
113/08	0	36,000,000	360,000,000	27,388,161	273,881,610	註銷限制員工 權利新股 1,500 股	無	註 18

註 1：95 年 09 月 11 日經授中字第 09532818990 號函核准在案。

註 2：99 年 05 月 21 日經授中字第 09932073310 號函核准在案。

註 3：99 年 11 月 08 日經授中字第 09932799690 號函核准在案。

註 4：100 年 11 月 08 日經授中字第 09932799690 號函核准在案。

註 5：101 年 11 月 29 日經授中字第 10132775110 號函核准在案。

註 6：102 年 09 月 10 日經授中字第 10233875430 號函核准在案。
 註 7：103 年 12 月 09 日經授中字第 10333949790 號函核准在案。
 註 8：104 年 10 月 07 日經授中字第 10433803390 號函核准在案。
 註 9：105 年 10 月 27 日經授中字第 10534404210 號函核准在案。
 註 10：106 年 02 月 20 日經授中字第 10633094020 號函核准在案。
 註 11：106 年 08 月 18 日經授中字第 10633490130 號函核准在案。
 註 12：106 年 12 月 12 日經授中字第 10633736750 號函核准在案。
 註 13：108 年 04 月 26 日經授中字第 10833254250 號函核准在案。
 註 14：111 年 08 月 10 日經授中字第 11133490060 號函核准在案。
 註 15：112 年 08 月 17 日經授中字第 11233499020 號函核准在案。
 註 16：113 年 03 月 21 日經授商字第 11330446820 號函核准在案。
 註 17：113 年 05 月 10 日經授商字第 11330558230 號函核准在案。
 註 18：113 年 08 月 16 日經授商字第 11330757400 號函核准在案。

2.股份種類

114 年 04 月 15 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	27,388,161	8,611,839	36,000,000	上櫃公司股票(註)

註：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於 108 年 4 月 22 日同意本公司股票上櫃，於 108 年 4 月 23 日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣(證櫃審字第 10800032533 號)。

(二)總括申報制度相關資訊:無此情形。

(三)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比率占前十名之主要股東名稱、持股數額及比例如下：

114 年 04 月 11 日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
寬逸投資有限公司		3,097,490	11.31
陳綺敏		935,961	3.42
花旗託管波露寧新興市場基金公司專戶		741,654	2.71
李職民		599,073	2.19
慧榮投資股份有限公司		571,717	2.09
大通託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶		507,000	1.85
張晉璋		494,000	1.80
新制勞工退休基金		411,000	1.50
渣打託管瑞穗證券股份有限公司		372,000	1.36
盧俊郎		356,464	1.30

(四)公司股利政策及執行狀況：

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，依法應先提繳稅款，彌補以往年度虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累計已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提

列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派之。

本公司董事會得經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

另依據本公司章程規定，本公司股利政策，須視公司目前及未來之投資環境、未來投資計畫、財務結構及營運情形，並兼顧股東利益等因素，本公司每年至少就當年度餘額（不含累積未分配盈餘）提撥不低於 20% 作為股利分派，惟如當年度餘額（不含累積未分配盈餘）低於實收股本百分之十時，得不予分配；股利政策得以股票或現金之方式分派之，惟現金股利分派之比例以不低於當年度發放股利總額 10%。

法定盈餘公積累計已達公司實收資本額時，得不再提列。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

上述股利政策經 111 年股東常會決議通過後實施。

2. 以前年度股東股利分配之情形：

本公司 112 年度之盈餘分配案業於 113 年 06 月 03 日股東會決議通過：

	盈餘分配案	每股股利（元）
法定盈餘公積	\$35,420,248	-
現金股利	\$178,275,680	\$6.55

上述 112 年之盈餘分配案並經本公司董事會 113 年 06 月 24 日董事會決議，除息基準日及相關日期如下：

- (1) 除息交易日：113 年 07 月 11 日。
- (2) 除息基準日：113 年 07 月 17 日。
- (3) 股票最後過戶日：113 年 07 月 12 日。
- (4) 股票停止過戶期間：自 113 年 07 月 13 日起至 113 年 07 月 17 日止。
- (5) 現金股利發放日：113 年 08 月 01 日。

3. 本年度已擬議股東股利分配之情形：

本公司 114 年 03 月 10 日董事會擬議 113 年度盈餘分配案如下：

	盈餘分配案	每股股利（元）
法定盈餘公積	\$47,982,218	-
現金股利	\$273,881,610	\$10.00

有關 113 年度之盈餘分配案預計於 114 年 06 月 09 日召開之股東會決議通過。

4. 預期股利政策將是否有重大變動：無此情形。

(五) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本年度無擬議股票股利，故不適用。

(六)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應以不低於當年度獲利狀況之 10% 分派員工酬勞及應以不高當年度獲利狀況之 1% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞發放之方式得以股票或現金為之，發放之方式、數額及股數應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞發放對象係以受聘或受雇於本公司從事工作，並經正式任用且享有勞工保險待遇之從業人員為限，並包含符合一定條件之從屬員工，而不包含臨時、試用人員。

董事(含獨立董事)酬勞發放之方式以現金為之，授權董事會於上限範圍內，以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

年度終了後，本財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，本合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年度董事、員工酬勞分配案業經 114 年 03 月 10 日董事會決議通過，配發董事酬勞 2,050 仟元、員工酬勞 91,470 仟元，與認列年度之估列金額相同。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未配發員工股票酬勞，故不適用。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：

(1) 股東會決議配發員工現金酬勞、股票酬勞及董事酬勞金額。若與董事會擬議分配金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年度董事、員工酬勞分配案業經 114 年 03 月 10 日董事會決議通過，配發董事酬勞 2,050 仟元與員工酬勞 91,470 仟元，擬提交 114 年 06 月 09 日本年度股東常會報告。

(2) 股東會決議配發員工股票酬勞者，所配發股數及其占盈餘轉增資之比例：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未配發員工股票酬勞。

(3) 考慮擬議配發員工、董事酬勞後之設算每股盈餘：

本公司 112 及 113 年度員工酬勞皆以現金發放，加以員工及董事酬勞皆已費用化，故對每股盈餘並無影響。

5.前一年度員工及董事人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、與其認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年 03 月 04 日董事會決議配發 112 年員工及董事酬勞如下，並已提 113 年 06 月 03 日股東常會報告，與認列年度之估列金額相同，實際配發情形並無差異情形：

單位：仟元

項 目	董事會通過數	實際配發數	差異
員工酬勞-現金	52,500	52,500	—
員工酬勞-股票	—	—	—
董事酬勞	1,700	1,700	—

6.員工、董事酬勞給付酬金之政策、酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性及執行情形：

公司章程規定，應以不低於當年度獲利狀況之 10%分派員工酬勞；及應以不高當年度獲利狀況之 1%為董監酬勞。依據 113 年度的財務報告，113 年度營業額為新台幣 1,736,083 仟元，較前一年增加 23%；稅後淨利新台幣 479,822 仟元，較前一年增加 35%；稅後基本每股盈餘由去年的 13.07 元增加至 17.69 元，較前一年增加 35%，113 年的經營績效較 112 年上升。113 年度董事、員工酬勞分配案業經 114 年 03 月 10 日薪酬委員會及董事會參考 113 年的營運績效成長幅度和公司章程規定，決議通過，配發董事酬勞 2,050 仟元、員工酬勞 91,470 仟元。並擬提交 114 年 06 月 09 日本年度股東常會報告。

單位：仟元

年度	項 目	董事會通過數	增減比率%
113 年度	員工酬勞-現金	91,470	+74.23%
	董事酬勞	2,050	+20.59%
	合計	<u>93,520</u>	+72.55%
112 年度	員工酬勞-現金	52,500	無
	董事酬勞	1,700	無
	合計	<u>54,200</u>	無

本公司董事「酬勞」來源依據「公司章程」第二十條規定及董事及「功能性委員會酬金給付辦法」辦理。「公司章程」第二十條規定，以不高於當年度獲利狀況之 1%為董監酬勞；「功能性委員會酬金給付辦法」規定，本公司董事「報酬」及「執行業務」相關費用，不論盈虧均須給付，依每月及出席執行業務情形給付一定金額。

113 年稅後純益較 112 年增加 35%，113 年董事酬金總額較 112 年增加 76 萬。若加計兼任員工領取之相關酬金總額後，113 年度較 112 年度增加 50%。故本年度稅後純益與酬金變動尚屬合理。

綜上所述，本公司支付員工、董事酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

(七)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)尚未屆期之公司員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：不適用。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

截至 114 年 04 月 15 日；單位：仟股；仟元

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行(註)				未執行			
					認股數量	認股價格(元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格(元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	盧俊郎	589	2.18%	574	36	20,664	2.12%	-	-	-	-
	副總經理	羅文陞										
	副總經理	彭恩德										
	協理	曾坤任										
	協理	李明義			15	75	1,125	0.06%	-	-	-	-
	協理	戴育哲										
	協理	陳浩昇										
	協理	高志宏										
	財務及會計部門主管	林詩堯										
員工	協理	黃榮彬	637	2.35%	572	36	20,592	2.11%	-	-	-	-
	資深經理	楊鈞清										
	資深經理	羅淵文										
	協理	鄭偉中										
	經理	姚均翰										
	經理	鍾瑩慧			65	75	4,875	0.24%	-	-	-	-
	副理	黃群淵										
	副理	范彥虹										
	副理	邱嘉俊										
	課長	陳韋至										

註:員工認股憑證分別於(1)106 年 10 月及(2)108 年 4 月初次上櫃現金增資發行新股，保留員工認股部分。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

114 年 4 月 15 日

限制員工權利新股種類	111 第 1 次(期)限制員工權利新股
申報生效日期	111 年 7 月 20 日
發行日期	111 年 7 月 27 日
已發行限制員工權利新股股數	普通股 150,000 股
發行價格	以每股面額新台幣 10 元，無償發行
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.55%
員工限制權利新股之既得條件	員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得： (一) 於各既得期間屆滿日仍在職； 1.於限制員工權利新股發行日後滿一年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 2.於限制員工權利新股發行日後滿二年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 3.於限制員工權利新股發行日後滿三年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 4.於限制員工權利新股發行日後滿四年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。 (二) 於各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事； (三) 於各既得期間內達成本公司所設定之個人工作績效評核指標。 個人工作績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核評等至少為甲等(含)以上。
員工限制權利新股之受限制權利	一、 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。 二、 除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，針對尚未達成既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 三、 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。 四、 員工未達既得條件前於本公司股東會之出席提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。 五、 於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股應依減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條件前因持有限制員工權利新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將獲配之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	一、 員工獲配或認購限制員工權利新股後，遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷，其他發生繼承等例外情形時，應依下列方式處理：

	(一) 員工因故辦理離職、退休或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。 (二) 因受職業災害致身體殘疾或死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理： 1. 員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。 2. 員工因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。 3. 員工非因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。 (三) 員工經由公司核准辦理留職停薪者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股得於復職後恢復權益，惟其獲配限制員工權利新股之既得期間應依其辦理留職停薪期間遞延之。 (四) 因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，如轉任當年度符合本辦法第五條規定之其他既得條件，得由董事長或其授權主管人員於本辦法第五條約定之時程比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。 (五) 對於已達成既得條件而得領取之限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法及第六條第一項之信託約定受領。如因公司作業需要，員工本人或繼承人有須配合辦理股份領取作業，員工本人或繼承人應自本公司依本辦法通知領取之日起一年內配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為員工或其繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。 二、 員工違反本公司服務契約、工作規則時，本公司得依情節之輕重向該員工無償收回尚未既得之股份(包含其股票股利)並辦理註銷。 三、 如員工終止或解除本公司就限制員工權利新股發行之委託辦理信託保管之代理授權時，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 四、 對於公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。 五、 併購之處理 尚未既得股票應由併購相關契約或計畫約定變更。
已收回或收買限制員工權利新股股數	20,500 股
已解除限制權利新股之股數	67,500 股
未解除限制權利新股之股數	62,000 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率	0.23%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

限制員工權利新股種類	112 第 1 次(期)限制員工權利新股
申報生效日期	113 年 4 月 3 日
發行日期	113 年 4 月 22 日
已發行限制員工權利新股股數	普通股 180,000 股
發行價格	以每股面額新台幣 10 元，無償發行
已發行限制員工權利新股股數占已發	0.66%

行 股 份 總 數 比 率	
員工限制權利新股之既得條件	員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得： (一) 於各既得期間屆滿日仍在職； 1.於限制員工權利新股發行日後滿一年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 2.於限制員工權利新股發行日後滿二年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 3.於限制員工權利新股發行日後滿三年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 4.於限制員工權利新股發行日後滿四年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例25%。 上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。 (二) 於各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事； (三) 於各既得期間內達成本公司所設定之個人工作績效評核指標。 個人工作績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核評等至少為甲等(含)以上。
員工限制權利新股之受限制權利	一、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。 二、除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，針對尚未達成既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 三、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。 四、員工未達既得條件前於本公司股東會之出席提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。 五、於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股應依減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條件前因持有限制員工權利新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將獲配之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處 理 方 式	一、員工獲配或認購限制員工權利新股後，遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷，其他發生繼承等例外情形時，應依下列方式處理： (一) 員工因故辦理離職、退休或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。 (二) 因受職業災害致身體殘疾或死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理： 1. 員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。 2. 員工因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。 3. 員工非因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。 (三) 員工經由公司核准辦理留職停薪者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股得於復職後恢復權益，惟其獲配限制員工權利新股之既得期間應依其辦理留職停薪期間遞延之。 (四) 因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，如轉任當年度符合本辦法第五條規定之其他既得條件，得由董事長或其授權主管人員於本辦法第五條約定之時程比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。

	(五) 對於已達成既得條件而得領取之限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法及第六條第一項之信託約定受領。如因公司作業需要，員工本人或繼承人有須配合辦理股份領取作業，員工本人或繼承人應自本公司依本辦法通知領取之日起一年內配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為員工或其繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。 二、 員工違反本公司服務契約、工作規則時，本公司得依情節之輕重向該員工無償收回尚未既得之股份(包含其股票股利)並辦理註銷。 三、 如員工終止或解除本公司就限制員工權利新股發行之委託辦理信託保管之代理授權時，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 四、 對於公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。 五、 併購之處理 尚未既得股票應由併購相關契約或計畫約定變更。
已收回或收買限制員工權利新股股數	6,000
已解除限制權利新股之股數	0
未解除限制權利新股之股數	174,000
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率	0.64%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

114 年 4 月 15 日 單位:股/新台幣仟元

	職 稱	姓 名	取 得 限 制 工 利 股 新 數	取 得 限 工 新 股 已 股 數 之 占 行 總 數 比 率 (註2)	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已 解 限 之 股 數	發 行 格 格	發 行 金 額	已 解 除 之 限 制 股 數 已 股 數 比 率 (註2)	未 解 限 之 股 數	發 行 格 格	發 行 金 額	未 解 除 之 限 制 股 數 已 股 數 比 率 (註2)
經 理 人	總經理	劉安炫	140,000	0.51%	6,000	0	0	0.02%	134,000	0	0	0.49%
	副總經理	羅文陞										
	協理	吳興仁										
	協理	陳浩昇										
	協理	鄭偉中										
員 (註二)	資深經理	周豐雯	88,000	0.32%	22,500	0	0	0.08%	65,500	0	0	0.24%
	資深經理	姚均翰										
	專案經理	黃揚哲										
	專案經理	陳韋至										
	專案經理	汪彥儒										
	專案經理	羅振源										
	專案經理	譚光宏										
	專案經理	簡嘉宏										
	專案經理	曹家圻										
	專案副理	李湘荃										

註1：取得限制員工權利新股前十大員工係指經理人以外之員工。

註2：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

1.業務範圍：

(1)公司所營業務之主要內容：

E603050	自動控制設備工程業
E605010	電腦設備安裝業
F113050	電腦及事務性機器設備批發業
F118010	資訊軟體批發業
F119010	電子材料批發業
F199990	其他批發業
F213030	電腦及事務性機器設備零售業
F218010	資訊軟體零售業
F219010	電子材料零售業
F299990	其他零售業
F401010	國際貿易業
I199990	其他顧問服務業
I301010	資訊軟體服務業
I301020	資料處理服務業
I301030	電子資訊供應服務業
I501010	產品設計業
I599990	其他設計業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	112 年度營收 金額	112 年度營收 比率(%)	113 年度營收 金額	113 年度營收 比率(%)
半導體晶圓測試-後段測試載板	1,152,957	81.76	1,395,888	80.40
半導體晶圓測試-前段測試載板	229,161	16.25	303,878	17.50
其他	28,107	1.99	36,317	2.10
合計	1,410,225	100.00	1,736,083	100.00

(3)公司目前之商品(服務)項目：

本公司提供之產品與服務在半導體供應鏈中屬於 IC 測試產業一環，在 IC 產業中扮演不可或缺的角色。本公司所提供產品及服務主要為製造及銷售半導體晶圓測試之各種測試載板，包含前段測試載板（晶圓探針卡測試載板）、後段測試載板（IC 測試載板及 IC 老化測試載板）及其他相關測試載板等項目，如測試載板所需搭配 IC Socket、Probe Head、IC Burn-in Board 測試、IC 測試實驗室環境等，都是我們可以提供的產品與服務。我們長期與客戶一起發展，累積深厚的測試整合技術和經驗，能提供客戶兼具成本效率與完整可靠的測試解決方案。

(4)計劃開發之新商品

- PCIE Gen6 64Gbps/Serdes 224Gbps 全速測試晶圓探針卡及測試載板
- 5G mmWave 28G/39G/55/60GHz probe card/multi-site OTA load board 全速 IC 測試介面載板
- 2 奈米製程 high pin count (>70000) MEMS probe card
- 0.25mm/0.3mm BGA pitch multi-DUT load board IC 測試介面載板
- Non-skip die multi-DUT AP probe card
- Multi-site hybrid MEMS probe card/load board IC 測試介面載板
- 0.32mm BGA pitch multi-DUT, BIB for LC2 老化測試介面專板
- 增加美系客戶使用之 BIB platform

2.產業概況

(1)產業現況與發展

全球半導體貿易統計協會(WSTS)的數據顯示,2024 年全球半導體銷售額達 6,276 億美元,增長 19.1%。WSTS 預估,2025 年全球半導體市場的增幅將回落到 11.2%。

2024 年美國半導體市場總銷售值達 1,946 億美元,較 2023 年成長 44.8%;日本半導體市場銷售值達 466 億美元,較 2023 年衰退 0.4%;歐洲半導體市場銷售值達 513 億美元,較 2023 年衰退 8.1%;中國大陸市場銷售值達 1,825 億美元,較 2023 年成長 18.3%;亞太地區半導體市場銷售值達 1,527 億美元,較 2023 年成長 12.5%。

世界半導體貿易統計協會(WSTS)則認為 AI 相關投資強勁,帶動 GPU 等邏輯晶片、記憶體需求擴大,原預估 2024 年度全球半導體市場規模美金 6,112.31 億元,在近期上已上修至美金 6,268.69 億元,將超越 2022 年的美金 5,740.84 億元,創下歷史新高紀錄;其中 WSTS 預估晶片(IC)全球銷售額可至美金 5,344.99 億元,晶片銷售額中又包含記憶體(Memory)全球銷售額預估值美金 1,670.53 億元,CPU 等產品在內的邏輯(Logic)全球銷售額預估值美金 2,087.23 億元;而因 AI 的快速發展帶動資料中心需求,並將逐步落實至智慧型手機、個人電腦以及各種物聯網(IoT)裝置等更多終端裝置,將可望帶動 2025 年全球半導體市場達到美金 6,971.84 億元。

工研院產科國際所預估 2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元,較 2023 年成長 22.4%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 12,721 億元,較 2023 年成長 16.0%;IC 製造業為新臺幣 34,195 億元,較 2023 年成長 28.4%。其中,晶圓代工為新臺幣 32,438 億元,較 2023 年成長 30.1%,記憶體與其他製造為新臺幣 1,757 億元,較 2023 年成長 3.3%;IC 封裝業為新臺幣 4,233 億元,較 2023 年成長 7.7%;IC 測試業為新臺幣 2,002 億元,較 2023 年成長 5.0%。

根據工研院產科國際所的預測,台灣半導體產業的增長速度將優於全球同業。2024 年台灣半導體業總產值突破新台幣 5.3 兆元,年增幅達 22.4%,遠高於全球半導體業的 19.1%。展望 2025 年,台灣半導體業預估產業總產值將攀升至 6.2 兆元,年增幅仍預計保持在 16.2%,高於全球半導體業 11.2% 的增長預期。預期 2025 年台灣 IC 設計業產值約為 1 兆 4155 億元,年增 11.3%;IC 封裝業產值預計達 4608 億元,年增 8.9%;IC 測試業產值將達 2195 億元,年增 9.6%。

2024 年台灣 IC 產業產值統計結果

億新台幣	24Q1	季成長	年成長	24Q2	季成長	年成長	24Q3	季成長	年成長	24Q4	季成長	年成長	2024	年成長
IC 產業產值	11,667	-3.0%	15.7%	12,702	8.9%	25.1%	13,840	9.0%	24.0%	14,942	8.0%	24.2%	53,151	22.4%
IC 設計業	3,002	0.1%	25.1%	3,125	4.1%	16.4%	3,256	4.2%	13.1%	3,338	2.5%	11.3%	12,721	16.0%
IC 製造業	7,193	-4.3%	14.6%	8,071	12.2%	32.9%	8,965	11.1%	32.7%	9,966	11.2%	32.6%	34,195	28.4%
晶圓代工	6,749	-4.8%	14.9%	7,605	12.7%	34.7%	8,508	11.9%	34.7%	9,576	12.6%	35.1%	32,438	30.1%
記憶體與其他製造	444	4.0%	9.4%	466	5.0%	8.9%	457	-1.9%	3.9%	390	-14.7%	-8.7%	1,757	3.3%
IC 封裝業	987	-4.1%	5.0%	1,022	3.5%	10.2%	1,114	9.0%	7.6%	1,110	-0.4%	7.9%	4,233	7.7%
IC 測試業	485	-0.6%	4.3%	484	-0.2%	4.5%	505	4.3%	3.1%	528	4.6%	8.2%	2,002	5.0%
IC 產品產值	3,446	0.6%	22.8%	3,591	4.2%	15.4%	3,713	3.4%	11.8%	3,728	0.4%	8.8%	14,478	14.3%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

台灣企業擁有尖端製程、IC 設計及封裝產業高度的競爭力，特別是在先進製程的技術方面領先全球。然而，在材料與設備部分，台灣的自給率不高，成為了一項風險。隨著自駕車、新能源、無線通訊等創新發展，其耐高電壓、高電流、高散熱效率、高操作頻率等優越材料特性，各界預期其將成半導體產業明日之星，世界主要國家亦積極投入並發展茁壯，特別是目前以 IDM 廠為主要 player，台灣僅在代工領域有其角色，然而在設計及模組及應用市場段，仍需追趕。2025 年，受惠於人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的需求攀升，半導體產業持續大幅成長。從雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求提升，以及新興技術的演進對高功能半導體元件需求攀升，使得需求不斷增加。川普政府新上任，全球科技廠去中化、美國退出 OECD 全球稅收協議、加重中國關稅課徵等，皆影響全球半導體供應鏈。

2021~2025(e)年台灣 IC 產業產值

億新臺幣	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025 (e)	2025 (e) 成長率
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	19.1%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

說明：

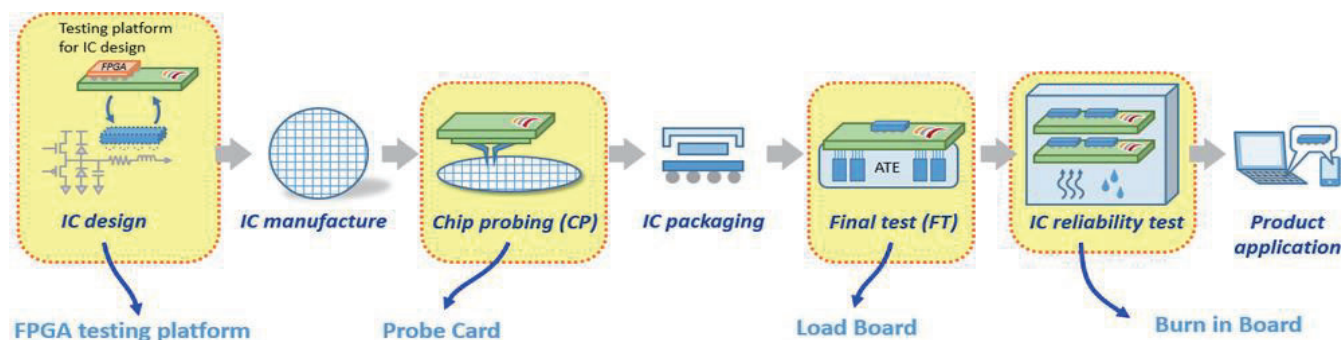
註：(e)表示預估值(estimate)。

- (1) IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業。
- (2) IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造。
- (3) IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。
- (4)上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。

(2) 半導體測試產業與產業上、中、下游之關聯性：

在半導體製程中，測試產業扮演重要的角色，尤其對於製程良率、品質良窳、成本控管，測試的時程要求與效率，都需要測試產業提供測試機台、測試設備、專業驗證服務及各項測試的零組件，替各階段 IC 產品的生產流程品質把關。

下圖為測試產業在 IC 半導體的生產流程中，對每一階段所提供的測試服務流程圖：



雍智累積長久的測試服務整合能力，致力提供半導體測試最佳化的整合解決方案，舉凡前端的 IC 設計(FPGA IC 設計模擬平台)、IC 晶圓測試(Probe Card)，以及後段的 IC 老化測試(Burn in Board)及 IC 封裝測試(Loard Board；Final Test (FT))等，雍智能設計、製造並整合客戶測試的需求，同時提供兼具測試效率與成本的的最佳解決方案。

(3) 本公司提供之營業務主要內容：

本公司主要從事半導體測試介面產品之研發、生產與銷售，主要產品包括前段測試載板（晶圓探針卡測試載板(Probe Card)）、後段測試載板（IC 測試載板(Load Board)及 IC 老化測試載板(Burn-in Board)）及其他相關測試載板和服務：

A. 前段測試載板:晶圓探針卡(Probe Card)測試載板

本公司主要提供晶圓探針卡(Probe Card)當中之 PCB 測試載板的電路設計和製造為主。探針卡(Probe Card)是一片佈滿探針的 PCB 測試電路板，加上探測頭(Probe Head)、探測針(Probe Needles)、Substrate 載板等機構組成，用於機台和待測晶圓間測試分析的介面測試，檢驗製作完成後整片晶圓的良率，主係以探針卡上面的探針(Probe needles)對裸晶進行電性量測，篩選出瑕疵或故障的晶粒等不良品，降低不良品進入後段封裝製程，避免構裝成本的浪費。

B. 後段測試載板: IC 測試載板(Loard Board)

IC 測試板是介於封裝之後的 IC 及測試機台之間的介面卡板，主要功能為承載封裝後之 IC 做為載體之用，IC 測試載板內部有線路連接封裝後之 IC 與測試機台，一般用於高階的封裝製程中。

C. 後段測試載板: IC 老化測試板(Burn in Board)

人工智慧 (AI) 時代來臨，物聯網、車用電子發展迅速，加上 5G 將成為主流規格，未來半導體產業將走向更市場導向、更創新的應用領域，尤其汽車市場逐步走向車聯

網、電動車領域，需要更多駕駛資訊輔助整合系統，因安全性之考量，需仰賴 IC 高度可靠性運作，近年來因封裝技術提升，以多個 IC 置放至同一封裝體時，其整體壽命將會受到不同元件間的熱傳導相互干擾而下降，其產生的熱高達以往 IC 產品的數倍，因此溫度提高對 IC 壽命有一定程度的影響。老化板的設計及製作亦是 IC 測試的關鍵，由於半導體元件之應用頻率、速度、發熱、阻抗匹配等考量，在老化板的設計考量上相對複雜，隨著新興科技發展，愈來愈多之 IC 產品需經過老化測試。

(4)產品發展趨勢及競爭情形：

A.產品發展趨勢

伴隨著 IT 設備及裝置普及智慧手機等廣泛被使用，5G 高速傳輸技術的逐漸成熟、車聯網、物聯網、VR/AR、人工智慧 AI、(IOT)平台架構起智慧家庭/城市、智慧遠端照護及醫療、智慧工廠(工業 4.0)、及消費性行動裝置等新世代的應用發展，IC 晶片需要更強大運算能力、同時要求更小的體積、更低的電力消耗、更良好的通訊品質及更直覺的使用者介面操等，所執行這些功能的重要元件“IC”晶片就被賦予發展的核心重任。隨著 IC 製程技術精進朝向物理極限的微奈米化發展，才能製造出更微小輕薄、多疊構的 IC 封裝，以滿足這些推陳出新的應用發展，故未來半導體業將能繼續扮演各項產業火車頭的重要角色。

IC 產業一直朝向輕薄及微小化發展，近年 FOWLP(Fan-Out Wafer Level Package)技術逐漸取代傳統的 SiP(System in Package)技術，FOWLP 基本上就是將多個已知合格晶圓 KGD(Known Good Die)重構於晶圓載體上後，再經過晶圓及壓縮成型，能有效的縮減 IC 厚度及解決電源和訊號路徑過長等問題，讓產品更輕薄及效能更佳。但是 FOWLP 及 SiP 隨製程複雜化而單位價格逐漸升高，所以不論是 SiP 或 FOWLP 技術所生產的 IC 晶圓，都需要確保合格晶圓 KGD 的高良率，因為一個功能未盡完善的 Die 將造成整個 FOWLP 或 SiP 技術所生產的 IC 晶圓 Fail，形成生產成本和效率的重大損失。因此越來越多的客戶選擇在晶圓測試階段，不再僅有之前的晶圓 Probe card 的測試需求，而是逐漸要求能同時對 IC 功能作測試(Functional Test)，以確保之後執行先進製程封測時，可以獲得更高的良率，才能減少生產成本及提升品質。

因此如何在 IC 產品的 Wafer Level 階段執行功能測試(Functional Test)，挑選出功能正常及特性符合規格的 Die 就是一個重要課題。尤其當 IC 功能越來越強大，要求更快的速度及處理效能；對 IC 功能測試項目變多，造成在測試時，會產生高速及高頻所衍生的訊號干擾，因此 IC 測試載板(Load Board)及晶圓測試載板(Probe Card)也都要特別設計來因應，這發展趨勢將會對未來 IC 測試的一大挑戰，但是也是成長的機會。

一般 Load Board 需具備能完整測試 IC 功能的規格，而 Probe Card 僅測試 I/O 的 Open/Short，因此 Load Board 的電路設計較 Probe Card 相對複雜許多，而且 Load Board 也需要較多的 ATE(Auto Testing Equipment)相關知識搭配。

雍智科技長久於 Load Board 所累積的豐富經驗，讓我們站在相對有利的位置。我們會針對客戶需求，透過電路設計與線路佈局，以及對訊號及電力的匹配模擬，提供可靠及穩 PCBA+Substrate+Socket 或 PCBA+Substrate+Probe Head 等整體解決方案。讓客戶面對單一窗口快速有效解決問題，避免面對多個測試供應商，耗時耗力在溝通及釐清問題上。我們也積極規劃投入新的電路開發、佈局及模擬軟體，以強化我們 IC 設

計能力。

除了新產品開發，本公司製程上不斷致力於新的組裝技術的改進，例如：添購高著裝準度的 SMT 機器、精密溫控 Reflow 及 3D 量測儀器等設備，以建構 Fine Pitch 之 Substrate+PCBA 之組裝技術。並規劃於新廠設立無塵室，開發新的製程技術以滿足未來客戶對更高階產品的測試技術和環境需求。

B.產品競爭情形

本公司產品及服務，主要在 IC 測試產業的電路圖模擬分析測試、IC 晶圓片測試的 Probe Card、產品老化及穩定性的 Burn-in board 載板及 IC 封裝後測試使用的 Load board 載板。需要與客戶在產品開發時就合作了解測試的需求及規格，無論在設計 IC 初期或是機台的測試階段，都需要隨時和客戶溝通和解決問題。國內同類的競爭者，主要是從 PCB 製造、Socket 或探測針陸續發展延伸至測試電路設計，本公司以測試電路的設計和模擬為主要的服務內容，PCB 測試板和其他配件委外和知名廠商搭配。國外的競爭者主要來中國大陸業者。為即時且有效率的服務大陸地區的 IC 設計廠及封測廠，本公司在上海設有孫公司上海芯埕科技有限公司，與大陸的其他提供類似測試版服務的廠商競爭。

隨著 IC 終端產品發展趨勢，IC 電路設計不斷微米化，具有技術能力，能提供兼具成本與效率的 IC 測試載板供應商會越來越少。本公司較其他競爭者具有優勢之處在於本公司擁有 10 年的測試載板設計經驗累積，自主或與客戶一起開發高速傳輸 77GHz 至 112GHz 量產測試與驗證方案逐漸成熟，技術領先同業。此外，產品的布局完整，從 IC 設計的 FPGA、IC 晶圓片測試的 Probe Card、產品老化及穩定性的 Burn-in board 載板及 IC 封裝後測試使用的 Load board 載板，本公司都能提供一站式的產品和服務。本公司提供的測試產品品質穩定，且相對競爭對手良率高，加上相對眾多的 FAE 技術服務團隊能現場即時提供技術服務和測試問題的排除，與現有客戶保持穩定且長久的合作關係。對於新客戶而言，累積的經驗，更能全面提供在 IC 測試各個階段的技術服務及協助，以減低新產品量產的不利測試風險。

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展：

因應未來高速數位傳輸與無線應用相關電子產品及 AI 伺服器,資料中心之蓬勃發展，發展高頻高速之測試載板平台與解決方案是本公司未來研發重點。本公司未來產品研發計畫如下：

- PCIE Gen6 64Gbps/Serdes 224Gbps 全速測試晶圓探針卡及測試載板
- 5G mmWave 28G/39G/55/60GHz probe card/multi-site OTA load board 全速 IC 測試介面載板
- 2 奈米製程 high pin count (>70000) MEMS probe card
- 0.25mm/0.3mm BGA pitch multi-DUT load board IC 測試介面載板
- Non-skip die multi-DUT AP probe card
- Multi-site hybrid MEMS probe card/load board IC 測試介面載板
- 0.32mm BGA pitch multi-DUT, BIB for LC2 老化測試介面專板
- 增加美系客戶使用之 BIB platform

(2)研究發展人員與其學經歷

114 年 04 月 15 日

學歷分佈	人數(人)	比率	相關工作經驗 平均年資(年)
碩士/博士	29	22%	4.47
學士	95	73%	4.22
專科	6	5%	7.12
合計	130	100%	4.41

(3) 最近五年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年度 項目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	174,722	183,392	196,300	166,118	248,474

(4)最近五年度開發成功之技術或產品：

年度	技術或產品名稱
109	5G mmWave 29GHz/39GHz RF Multi-DUT 晶圓探針卡與 AIM Load Board Design 5G 智能手機 AP、車用多媒體以及記憶體控制晶片三溫測試晶圓探針卡與 Load Board Design BIB RF 一系列 Project Design 功分器架構, 有 1 對 16 port(工作頻率 800MHz~6GHz), 1 對 8 port(工作頻率 850MHz~2.5GHz)
110	5G mmWave 29GHz/39/55GHz RF Multi-DUT 晶圓探針卡 4/5 奈米製程 5G 智能手機 AP、電視 ASIC 晶片、高速運算三溫測試晶圓探針卡與 Load Board IC 測試載板 BIB RF 一系列 Project Design 功分器架構:1 對 16 port(工作頻率 800MHz~6GHz), 1 對 8 port(工作頻率 850MHz~2.5GHz)
111	5G AP probe card with hybrid probe to handle high-speed and high-current testing PCIE Gen5 probe card with advanced MEMS probes to run at 32Gbps loopback testing Success in 3nm test chip probe card engineering test Success in GPU 600Amp & AI 300Amp load board and burn-in board
112	0.3mm pitch multi-site load board IC 測試介面載板開發完成 Wifi7 multi-site IC 測試介面載板開發完成 MEMS 探針混針式探針卡驗證完成 5G mmWave 55GHz multi-site 探針卡驗證完成 老化測試介面專板設計 mmWave 28GHz 功分器驗證完成 2000W AI GPU IC 老化測試介面專板驗證完成

年度	技術或產品名稱
	適用於 mmWave 頻段自動化量測平台
113	Serdes 112Gbps PAM4 Retimer 測試介面載板及探針卡開發完成且量產 GPU 高功率 400Amp 高速 loop 測試介面載板驗證完成 應用於 5G AP MEMS 探針混針式探針卡順利量產 VG RF probe head 測試及可靠度驗證 美系及台系 BIB 測試平台建立及開發 自動量測平台開發驗證

4.長、短期業務發展計劃

(1)短期發展計畫：

- A.以技術、品質及服務持續深耕客戶關係。
- B.整合並發揮策略聯盟效益，以滿足客戶各種需求。
- C.統合內部資源協助客戶即時解決問題。
- D.培養國際行銷人才，拓展台灣成功經驗。

(2)中、長期發展計畫：

- A.加強產品及技術垂直整合，期能以整體解決方案提供客戶。
- B.持續開發策略聯盟夥伴並共創三贏。
- C.參與國際組織並透過展覽及成果發表，以增加知名度有利於拓展海外市場。

二、市場及產銷概況

1.市場分析：

(1)主要商品之銷售地區：

單位：新台幣仟元

年度 地區		112 年度		113 年度	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
外銷	亞洲	643,881	45.66%	520,559	29.98%
	其他	13,841	0.98%	22,849	1.32%
	小計	657,722	46.64%	543,408	31.30%
內銷		752,503	53.36%	1,192,675	68.70%
合計		1,410,225	100.00%	1,736,083	100.00%

(2)市場佔有率：

本公司所提供的產品與服務屬於測試產業供應鏈中的一環，有許多不同領域的測試供應商提供不同的服務，從測試設備機台、設計、零組件等。因提供 IC 測試的廠商眾多，且各具擅長的領域，故整體 IC 測試供應商的財務業務資訊有限，因此無法精確估算出本公司的市佔率。根據產業研究機構 TechInsights Inc 報告，2021 年雍智科技於全球

IC 測試產業 DIB (Device Interface Board) 名列全球第五。但此份統計無法提供完整的 DIB 整體市場詳細資訊，而且各家營收統計涵蓋其他測試產業的服務或產品，或其他非測試產業的產品，因此資料僅供參考。

Sales, \$M, Calendar Year

Rank	Company	Region	2018	2019	2020	2021
1	R&D Altanova	North America	48.00	49.00	54.50	60.50
2	Harbor Electronics	North America	42.00	49.00	57.00	53.23
3	TSE	Korea	27.12	28.97	32.45	46.34
4	Gorilla Circuits	North America	31.00	33.50	30.80	41.50
5	Keystone Microtech	Taiwan	21.40	26.68	28.80	31.45
6	Integrated Test Corporation	North America	27.50	28.70	25.70	30.00
7	Zero One	China	18.50	18.00	19.50	26.10
8	CMRSummit	North America	19.00	20.50	21.70	25.00
9	Synergie CAD	Europe	18.65	19.05	21.66	24.12
10	Chunghwa Precision Test	Taiwan	13.86	20.13	19.80	23.79
11	Sanmina	North America	19.60	20.50	21.00	22.52
12	Ace Tech Circuit	Korea	15.80	16.00	18.00	20.00
13	Hitachi High-Tech.	Japan	9.70	10.00	12.60	15.00
14	Dynamic Test Solutions	Singapore	12.40	12.00	10.80	11.16
15	T.I.P.S. Messtechnik	Europe	9.44	9.02	7.64	9.34
16	Hampoo	China	8.50	9.50	8.70	9.00
17	PWB Corporation	Japan	6.34	6.79	7.49	8.11
18	STEP SYSTEM	Korea	7.26	7.40	7.10	7.95
19	IT&T	Korea	6.35	6.10	6.80	7.55
20	GigaForce	China	6.60	6.50	6.70	7.00
21	Test21 Corporation	North America	4.00	3.90	4.50	5.60
22	SIENNA ECAD	Rest of World	5.25	5.00	4.95	5.15
23	Meritech	Korea	5.40	5.00	4.60	4.90
24	Dynalist Manufacturing	North America	2.70	2.80	3.20	3.70
25	Christian Enzmann	Europe	2.15	2.35	2.95	3.50
26	Finley Design Services	North America	3.10	3.30	3.20	3.50
27	Interface Technologies	Europe	1.80	2.00	2.90	3.35
28	DFW Test	North America	2.30	3.00	2.50	3.10
29	Phoenix PCB	North America	3.30	3.00	2.80	3.10
30	ATSPID	North America	2.00	2.50	2.85	3.00
31	Cibel	Europe	2.00	2.10	1.80	2.00
32	Contech	North America	1.50	1.80	1.60	2.00
33	M Specialties	North America	5.20	1.30	1.30	1.60
34	Salland Engineering	Europe	1.10	1.10	1.10	1.20
	Circuit Spectrum	North America	4.80	EX	EX	EX
	DDi Corp	North America	EX	EX	EX	EX
	Protos Electronics	North America	2.10	EX	EX	EX
	SaiBas Technologies	North America	1.00	EX	EX	EX
	SEMES	Korea	EX	EX	EX	EX
	Unicircuit	North America	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other		100.57	101.95	100.60	181.52
Total			519.29	538.44	559.59	706.88
Annual Growth				3.7%	3.9%	26.3%

Copyright © Techn Insights Inc. All rights reserved.
Distribution rights contained in T&Cs.
August, 2022

(3)市場未來之供需狀況與成長性：

A.需求方面

人類的食、衣、住、行、娛樂及醫療與 IC 的連結性越來越高。且終端產品日愈輕薄化，IC 體積也日益縮小，在 IC 高階成本逐漸增加的趨勢下，作為 IC 良率把關重要一環的 IC 晶圓測試板與 IC 封裝測試板需求勢必增加。

B.供給方面

在半導體產業先進製程日益精進下，具備能提供高階 IC 測試測試卡板的供應商估計會越來越少。加上與測試載板息息相關的探針卡與 IC 測試產業各廠商均有其專注擅長的領域，但隨技術的演進，若是供給者無法在技術上突破可能會逐漸被市場淘汰。本公司作為亞洲地區有能力提供高階 IC 測試載板供給者之一，將會持續投入研究開發先

進製程技術，以維持市場的競爭力。

(4)競爭利基：

- A.快速的整合及完整的研發人力。
- B.結合半導體封裝技術，發揮綜效。
- C.嚴謹精實的材料與在製品庫存管理，降低客戶庫存風險。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A.有利因素:

- a.擁有累積多年的研發測試核心技術以支援各項測試平台的認證產品。
- b. IC 產業將因應用面持續擴加，預估未來仍持續成長，有利公司營運成長。

B.不利因素與因應對策:

a.同業競爭價格，對毛利形成壓力：

因應對策：嚴格控制成本，緊縮支出，並妥善運用生產設備重大投資及固定資產決策，使邊際效益極大化。

b. PCB 委外採購，不利大量化訂單及成本結構

持續與多元供應商合作，分散供應風險及降低採購成本，並發展關鍵技術，提高客戶合作採用動機。

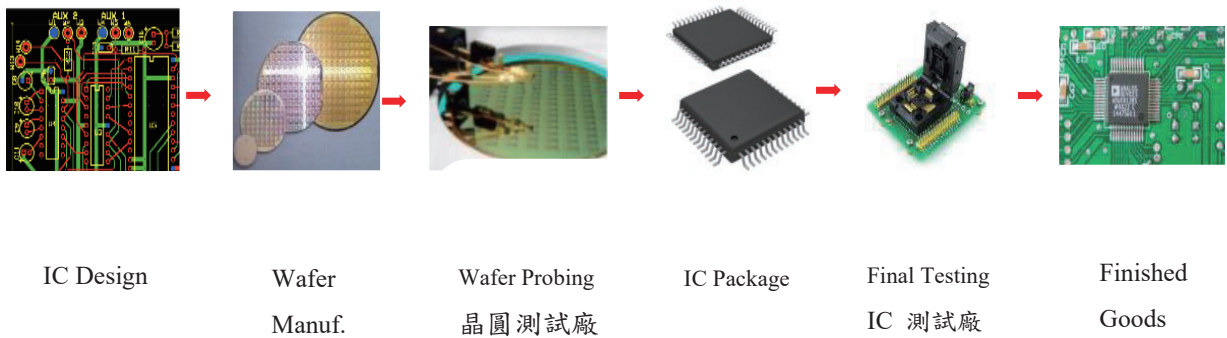
c.國際經濟情勢仍不穩定，影響匯率變化。

因應對策：盡量使用本地材料，並尋找替代材料以分散風險。

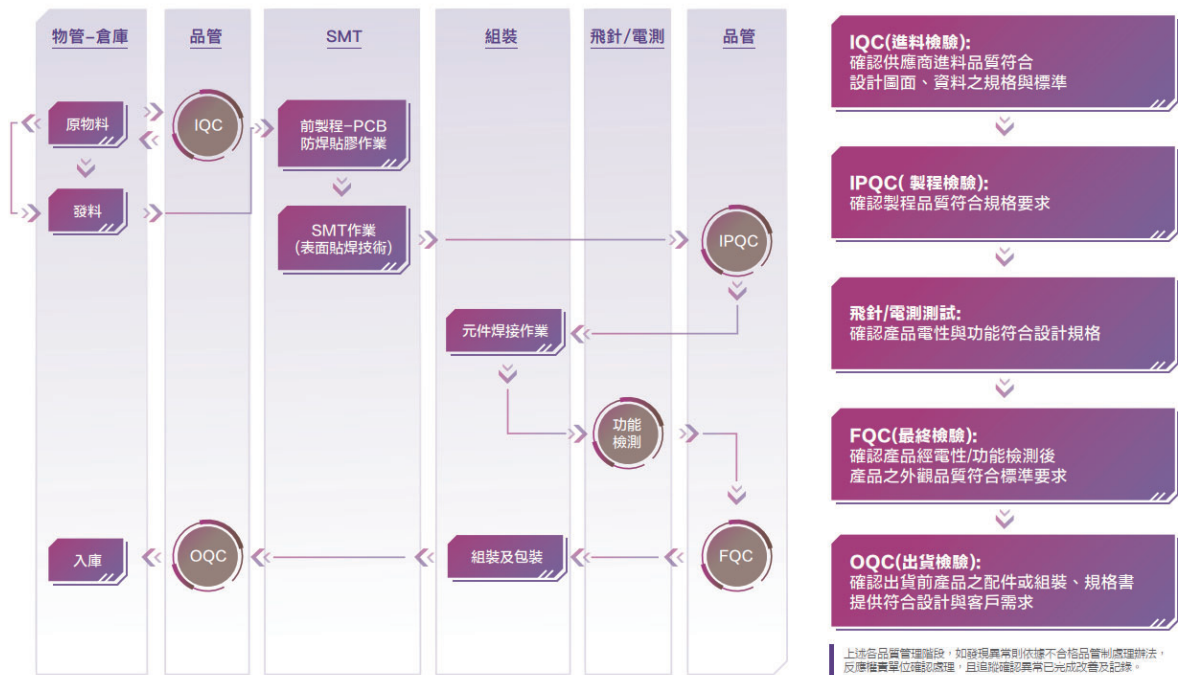
2.主要產品之重要用途及產製過程:

(1)主要商品重要用途:

IC 測試：提供前段 IC 晶圓測試(Probe Card)及後段 IC 封裝測試的載板(Load Board)及老化測試載板(Burn-in Board)。



(2)主要商品之產製過程



3.主要原料供應狀況：

本公司與主要供應商皆藉由長期合作建立夥伴關係，在供貨品質、價格及交期都得到充分支援，因此供貨相對穩定。

4.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明：本公司 112 年度及 113 年度其毛利率變動並未達 20%，故不擬分析價量差異。

5.主要進銷貨客戶名單：

(1)最近二年度或任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額、比例及增減變動原因：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	乙公司	20,964	6.70	無	乙公司	116,370	17.82	無
2	丙公司	4,654	1.49	無	丙公司	108,734	16.65	無
3	丁公司	43,692	13.97	無	丁公司	92,386	14.15	無
4	甲公司	47,917	15.32	無	甲公司	37,250	5.70	無
	其他	195,451	62.52	無	其他	298,209	45.68	無
	進貨淨額	312,678	100.00	無	進貨淨額	652,949	100.00	無

變動原因：

乙公司：本公司向乙公司主要是採購 PCB 板，113 年度進貨金額及進貨比率上升主要係前後段測試需求增加，對其增加採購所致。

丙公司：本公司向丙公司主要是採購前段測試載板相關配件，113 年度進貨金額及進貨比率上升主要係搭配前段測試出貨需求，對其增加採購所致。

丁公司：本公司向丁公司主要是採購 PCB 板，113 年度進貨金額及進貨比率上升主要係當年度前後段測試需求增加，對其增加採購所致。

甲公司：本公司向甲公司主要是採購前段測試載板相關配件，113 年度進貨金額及進貨比率下降主要係 112 年提前備貨所致。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例

單位：新台幣仟元；%

112 年度				113 年度			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
B 公司	141,246	10.02	無	B 公司	160,651	9.25	無
其他	1,268,979	89.98	無	其他	1,575,432	90.75	無
銷貨淨額	1,410,225	100.00	無	銷貨淨額	1,736,083	100.00	無

變動原因：

B 公司：主要是銷售後段測試載板的 IC 測試載板為主，113 年該客戶銷售金額增加，主要是該客戶對後段 IC 測試載板及前段晶圓測試需求皆有增加所致。

三、最近兩年度及截至年報刊印日止從業員工人數

截至 114 年 4 月 15 日 單位：人；年

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114.04.15
員工人數	直接員工	102	96	86
	間接員工	212	212	233
	合計	314	308	319
平均年歲		34 歲	35 歲	35 歲
平均服務年資		4.29	4.86	4.91
學歷分布比率	博士	0.64%	0.65%	0.63%
	碩士	14.65%	14.29%	13.79%
	大學(專)	69.42%	69.80%	72.41%
	高中	15.29%	15.26%	13.17%
	高中以下	0%	0%	0%

四、環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：無。
- 2.公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生之效益：無。
- 3.最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染經過，其有污染糾紛情事者，並應說

明處理經過：無。

4.最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

5.目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係

1.列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1)員工福利措施與實施情形：

本公司依法成立職工福利委員會，且根據相關法令提撥福利金，並責陳相關單位規劃執行以下福利政策：

A.員工保險：

(A)公司為員工投保勞、健保及勞退。

(B)團體保險：公司為員工辦理團體保險。

(C)出差平安險。

B.員工分紅、認股：參照政府法令及本公司相關辦法辦理。

C.訓練課程：為公司永續發展並提高員工素質，不定期舉辦各類課程講習。

D.團體活動：定期舉辦員工旅遊、部門聚餐、趣味競賽等活動，並撥款鼓勵員工參與。

E.禮金：諸如生日禮金、三節獎金等，另也對員工婚喪喜慶等撥有補助。

F.照顧員工健康，每年舉辦健康檢查。

G.設置哺集乳室，讓女性員工有一個溫馨友善、安全隱密的小天地。

(2)進修及訓練：

本公司為兼顧企業長期發展與提昇員工工作技能，進而提高工作績效，並達成公司經營目標，故十分重視員工職涯發展與人才培育。特將教育訓練分作以下三大類並執行之：

A.職前訓練：所有新進員工均須接受職前訓練，以幫助新進員工早日熟悉工作環境，瞭解公司制度及其權利、義務。

B.在職訓練：公司內部訓練、選派訓練及外聘訓練等方式。

C.人力培訓：視為公司對員工的一種長期投資，除利用各種在職訓練外，尚可採取出國考察、至國內著名公司參觀、出席各項會議、工作輪調等方式培訓員工。

(3)退休制度與實施情形：

本公司台灣員工全部適用新制退休金制度，依勞工退休金條例按工資分級表，每月提繳員工工資之百分之六儲存至勞保局設立之勞工退休金個人專戶，本公司員工亦得在其每月工資百分之六範圍內，自願另行提繳退休金，113 年及 112 年提繳之新制退休金分別為新台幣 11,214 仟元及 10,754 仟元。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

A.職業安全衛生管理機制:

雍智科技依職業安全衛生管理辦法設置職業安全衛生委員會，其委員會組成以董事長為主任委員、公司各單位主管擔任當然委員與勞工代表，共計 9 名委員組成，其中勞工代表人數 3 人，占比 33%。委員會每季定期召開會議討論職業安全衛生環保規畫與執行事項，113 年共計開會 4 次。且雍智科技設有甲種職業安全衛生業務主管與職業安全管理員各 1 人，113 年取得乙級職業安全衛生管理員資格，並設置職場護理師 1 人，定期檢討與推動職業安全衛生、員工健康、環保相關事項。

四大計畫執行成果:

a.人因性危害防止計畫:透過「肌肉骨骼問卷調查表」評估，評分為 3 分共 2 位(滿分 5 分)，經職醫評估與工作關聯性低，提供衛教指導協助降低員工不適，經由後測評分皆為 2 分，管理達成率 100%。安排健康促進講座「辦公室常見人因工程危害」，參與人數 30 人，整體滿意度 5.0 分(滿分 5 分)。

b.異常工作負荷促發疾病預防計畫:異常工作負荷促發疾病高風險者 0 人(低風險 162 人、中風險 69 人)。經由健康管理及每月健康宣導以提昇大家的健康常識，並增進自主健康管理能力。安排健康促進講座「如何預防心血管疾病」，參與人數 15 人，整體滿意度 4.9 分(滿分 5 分)。與職業專科醫師合作完成 113 年現場訪視。

c.執行職務遭受不法侵害預防計畫:已於公布欄及公司內網首頁公告「禁止工作場所職場暴力之書面聲明」及通報機制。執行職務遭受不法侵害案件 0 件。「職場不法侵害預防之危害辨識及風險評估表」調查結果為低風險。安排健康促進講座「終結職場暴力大作戰」，參與率 100%。

d.母性健康保護計畫:113 年度母性健康保護共 22 人(懷孕 7 人、產後 12 個月內 5 人、育齡期從事鉛作業 10 人)已全數完成危害辨識、風險評估及工作適性評估並提供相關衛教資訊，管理達成率 100%。會同職業醫學專科醫師完成 113 年辨識與評估工作場所環境及作業之危害並實施分級管理。哺(集)乳室進行每月清潔及管理，管理達成率 100%。

B. 緊急應變:

雍智科技已建立緊急應變措施管理計畫，將災害類型區分為天然災害、意外傷害、暴力滋擾、其他等四類，且將災害分為一至三級，訂定出預防與應變處理流程與方式；職安室每半年舉行一次一級緊急應變演練，每年一次二級應變及疏散演練。此外，消防演練每半年舉辦一次，其涵蓋單元訓練、實地演練或測試等內容，以降低與危害發生時之人員傷害與設備財產之損失。113 年緊急演練 2 次 80 人參與、消防演練 2 次 80 人參與。

C. 職業安全衛生教育訓練:

雍智科技為強化員工對於安全衛生相關規定之瞭解與認知，每年皆進行職業安全衛生教育訓練，以預防職業災害的發生。113 年教育訓練共 28 場次，時數共 84 小時，總訓練人數 373 人。

(5) 人權管理維護措施情形：

雍智科技為提供平等與健康之工作環境，公司已參考國際人權公約「聯合國世界人權宣言」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，訂有「人權政策與管理辦法」，於營運活動中嚴格禁止任何歧視行為，不因員工之種族、年齡、性別、性傾向、殘疾、懷孕、政治、宗教而有所歧視。所有員工皆依法簽定勞動契約，且於工作規則中明訂不得禁止工作者集會結社自由、不僱用童工及不強迫勞動等規定，以保障其工作者之基本人權。並會在新進員工時加強相關教育訓練。113 年度未有強制勞動之情事發生，亦未有人權相關之申訴案件。

2.最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

本公司管理制度及員工福利制度尚屬良好，勞資關係和諧，最近二年度及截至公開說明書刊印日止，本公司尚無與員工有重大勞資糾紛而遭受損失情事。本公司 秉持勞資互利、利益共用之宗旨下，未來可能發生勞資糾紛而遭受損失之可能性極微，故並未於財務報告中估計相關損失之金額。

六、資通安全管理

(一)本公司資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

1.資通安全風險管理架構：

由資安管理部偕同資訊管理處共同處理資訊安全及相關事宜，擬定相關內部控制程序管理，並定期進行內部資訊安全檢查。

2.資通安全政策：

(1) 目的：為建置本公司安全及可信賴的資訊運作環境，維持業務持續運作，降低資訊作業風險，保障資訊服務使用者之權益，建立資訊安全管理系統，規範本程序為最高指導方針，以達成資訊安全管理的目標。

(2) 範圍：本公司資訊安全管理範圍，包括本公司所屬各據點資訊作業之相關人員、管理制度、應用程式、資料、文件、媒體儲存、硬體設備及網路設施。

(3) 目標：避免資訊系統遭受來自內、外部人員不當使用或蓄意破壞，或當已遭受不當使用、蓄意破壞等緊急事故時，公司能迅速應變處置，並在最短時間內回復正常運作，降低該事故可能帶來之經濟損害及營運中斷。

(4) 程序：執行資訊機房、網路安全、系統開發及程式修改、資料安全、資訊保密、智慧財產權等管理。

3.具體管理方法：

本公司近年來完成多項資訊安全強化專案，範圍包含：

- (1) 強化內外網路安全：
 - A.使用一線品牌之次世代防火牆進行網段隔離及保護。
 - B.導入資訊安全管理系統，加強外來網路設備之監控機制。
 - C.增強重點帳號保護,增加系統管理員帳號防護機制。
 - D.強化各分點辦公室網路設備安全控管與防護。
- (2) 加強端點安全：
 - A.Windows 定期更新。
 - B.導入端點管控系統管理。
 - C.佈署知名防毒軟體防護。
- (3) 資料外洩保護：
 - A.USB 儲存設備管控。
 - B.使用者權限分級。
 - C.個人行動裝置相機管控。
 - D.通訊軟體檔案傳輸控管。
 - E.遠端桌面軟體控管。
- (4) 郵件安全：
 - A.垃圾、病毒或釣魚郵件阻擋。
 - B.建立郵件備存機制。
- (5) 增強 IT 基礎架構：
 - A.建立資料異地備份機制。
 - B.伺服器及網路叢集架構建立。
- (6) 提升員工資安意識：
 - A.不定期透過員工入口網站進行資安政策宣導。
 - B.資訊人員每月進行資安事件的研討。
 - C.每年度舉辦內、外部資安教育訓練。
- 4. 投入資通安全管理之資源：

本公司積極強化整體資訊安全架構，具體進行多項資訊安全強化專案，項目如下：

 - (1)強化系統開發安全，持續評估 Code Review 相關軟體。
 - (2)增加編列預算，強化網路及電腦作業安全。
 - (3)門禁管理系統全加密升級。
 - (4)有線與無線網路全面汰換升級。
 - (5)2024年度投資在資訊安全設備提升及更新金額為1,500萬元。
 - (6)2025年度全職的資安人員共計有1名資安主管及3名專職資安人員配置。
 - (7)預計114年度取得ISO 27001認證，提升整體資訊安全程度。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年	113 年	差異	
			金額	%
流動資產	2,097,935	2,094,125	(3,810)	(0)
非流動資產	482,805	966,792	483,987	100
流動負債	352,295	493,934	141,639	40
負債總額	358,047	513,839	155,792	44
股本	272,177	273,882	1,705	1
資本公積	323,750	366,444	42,694	13
保留盈餘	1,635,734	1,937,472	301,738	18
權益總計	2,222,693	2,547,078	324,385	15

(二)最近二年度增減比例變動分析說明：

- 1.非流動資產增加：主要係 113 年購買辦公室所致。
- 2.流動負債及負債總額增加：主要係 113 年應付帳款及其他應付款較去年增加，使流動負債及負債總額相對增加。

二、財務績效

(一)經營結果比較分析表：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業收入	1,410,225	1,736,083	325,858	23
營業成本	(704,626)	(815,867)	(111,241)	(16)
營業毛利	705,599	920,216	214,617	30
營業費用	(282,502)	(424,988)	(142,486)	(50)
營業淨利	423,097	495,228	72,131	17
營業外收入及支出	19,613	89,024	69,411	354
稅前淨利	442,710	584,252	141,542	32
所得稅費用	(88,508)	(104,430)	(15,922)	(18)
本期淨利	354,202	479,822	125,620	35
本期綜合損益總額	353,985	481,662	127,677	36

(二)最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者：

- 1.營業收入、營業毛利、稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額增加：主要係 113 年度後段晶圓測試載板需求增加所致。

- 2.營業費用增加：主要係 113 年度員工福利費用較 112 年增加所致。
- 3.營業外收入及支出增加：主要係 113 年度兌換利益 62,697 仟元，較 112 年兌換損失 2,478 仟元，增加 65,175 仟元所致。

(三) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

1.預計銷售數量與其依據：

依據全球和台灣 IC 產業動向及前端客戶預期，未來半導體市場 IC 相關應用仍不斷推陳出新，且台灣在半導體 IC 設計和晶圓製造、封裝測試全權佔有相當比重。2024 年起 AI 興起，使相關 IC 蓬勃發展，公司預估未來展望，AI 將會逐漸由 GPU 和 CPU 能夠處理數兆參數規模的語言模型等大型處理器晶片，逐漸往工業端和消費性 IC 發展，例如 AI 機器人、車用處理器、AI 個人電腦發展和高速傳輸晶片發展等。本公司預期未來高端 IC 產品的測試需求長期仍會持續穩健成長。

2.對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

長期半導體產業仍會不斷發展，尤其 2024 年開始興起的 AI 晶片，未來會從大型處理器，逐漸分散到工業和消費端應用，並帶動高頻高速 IC 需求；另電動車持續普及，帶動產業車用 IC 需求穩定成長，因此本公司長期營運及財務仍會隨台灣整體 IC 產業和世界半導體的成長趨勢呈現正向的關聯。

本公司為了提供客戶兼具成本效率及更完整可靠的解決方案及進一步尋求高成長的動力，除持續投入研發資源，與客戶共同開發對下一世代的先進測試製程技術及建構相關的測試實驗室環境，持續維持公司的未來的競爭力和營收成長。

三、現金流量

1.最近年度現金流量分析：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)比例
營業活動淨現金流入(出)	491,949	473,405	(4)
投資活動淨現金流入(出)	(148,427)	(422,613)	185
融資活動淨現金流入(出)	(212,474)	(186,794)	(12)
增減比例變動分析說明：			
1.投資活動淨現金流出：113 年度投資活動淨現金流出相較 112 年度增加，主要是 113 年購買辦公室所致。			

2.流動性不足之改善計畫：本公司資金尚屬充裕，未有流動性不足之情形。

3.未來一年(114 年度)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計來自投 資活動 淨現金流量	預計來自融 資活動 淨現金流量	預計現金剩 餘(不足)數 額	預計現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
1,231,014	354,655	(121,000)	(255,882)	1,208,787	—	—
1.未來一年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動淨現金流量：預計 114 年營收持續成長，產生正向營業活動淨現金流。 (2) 投資活動淨現金流量：預計 114 年購買機器設備，持續投資資本支出。 (3) 融資活動淨現金流量：預計 114 年盈餘分配發放 113 年之現金股利。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。						

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

- 1.重大資本支出之運用情形及資金來源：基於公司長期營運所需及擴充產能，於 113 年 3 月購置土地及廠房。資金來源係全部來自於公司營運所產生之資金，並未向外舉債。
- 2.預期可能產生效益：預計購入新廠辦後，本公司整體營運管理預計將更有效率，並直接節省龐大租金支出及增加同仁的向心力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1.本公司轉投資政策

本公司對轉投資事業之管理政策，除依內部控制制度中之投資循環規定辦理，另訂「取得或處分資產處理程序」、「對子公司監督與管理辦法」、「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」規範，作為轉投資事業控制及監督之依據，建立子公司營運風險管理機制，以發揮最大之經營績效。

- 2.最近年度轉投資獲利或損失之主要原因及改善計畫：本公司 113 年度採用權益法之投資損失為 21,257 仟元，因大陸子公司及美國子公司分別於 112 年及 113 年新設立，營運初期產生虧損。
- 3.未來一年投資計畫：將視本公司之營運需求，安排投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動影響：

截至年報刊印日止，本公司並無對外(包含金融機構及非金融機構)借款之情事，且本公司最近年度利息收入之金額，以及各該金額占營業收入淨額之比例並不重大，故整體而言，利率變動對本公司損益並無重大影響。

2.匯率變動影響：

本公司外銷之應收帳款、採購部分原料、設備等採購係採外幣結算，加上外幣的銀行存款，因而易受匯率變動影響。本公司 112 年及 113 年度之兌換利益(損失)分別為(2,478)仟元及 62,697 仟元，占各該年度營業收入淨額分別為(0.18%)及 3.61%；本公司將隨時注意匯率相關之國際金融資訊，並與金融機構保持密切聯繫，以充分掌握匯率變動趨勢，同時本公司將視匯率變動情形，適時調整外匯持有部位，以降低匯率變動對損益造成之影響。

3.通貨膨脹影響：

根據行政院主計處公布之 114 年 1 月份發布最新消費者物價總指數(CPI，以 110 年為基期 100)，113 年全年我國 CPI 指數較 112 年上漲 2.18%；就主要國家物價變動，日本上漲 2.7%、新加坡上漲 2.4%、香港上漲 1.7%、中國大陸上漲 0.2%、南韓上漲 2.3%，美國上漲 2.9%。最近年度通貨膨脹情形，對本公司損益並無重大影響。未來本公司將持續密切觀察物價指數變化，視通貨膨脹對本公司的影響，適時反應產品售價以因應物價波動成本上揚之影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專注於本業經營，財務操作以保守穩健為原則，並未從事高風險、高槓桿投資。本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」，相關作業程序業經股東會決議通過，作為本公司執行相關交易之依據。最近一年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性商品交易之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司的核心技術為測試板電路設計及線路佈局、對訊號及電力之匹配模擬等，自建各式之電路設計模組化，協助客戶解決在測試端所遇到的測試困難點，以現有機構及 PCB 電路板設計技術的基礎下發展，配合客戶的對電路設計困難度較高的 IC 晶片產品測試需求，補足現有測試設備及技術無法配合的瓶頸。

(1)未來研發計畫：

A.維持後段測試載板產業優勢：

因應未來高速數位傳輸與無線應用相關電子產品及 AI 伺服器,資料中心之蓬勃發展，發展高頻高速之測試載板平台與解決方案是本公司未來研發重點，為了持續維持競爭優勢及配合客戶需求，以下為研究發展重心：

- 5G mmWave 28G/39G/55/60GHz probe card/multi-site OTA load board 全速 IC 測試介面載板
- 0.25mm/0.3mm BGA pitch multi-DUT load board IC 測試介面載板
- Multi-site hybrid MEMS probe card/load board IC 測試介面載板
- 0.32mm BGA pitch multi-DUT, BIB for LC2 老化測試介面專板

■ 增加美系客戶使用之 BIB platform

B. 發展全速測試晶圓探針卡：

IC 功能整合度越來越高，多核心及高速介面、高密度排版等之產品，使得產品越變越複雜。IC 設計前的系統規畫及模擬測試分析，隨產品的複雜度提高，就變得愈來愈重要。以下為前段測試載板（晶圓探針卡測試載板）研究發展重心：

■ PCIE Gen6 64Gbps/Serdes 224Gbps 全速測試晶圓探針卡及測試載板

■ 5G mmWave 28G/39G/55/60GHz probe card/multi-site OTA load board 全速 IC 測試介面載板

■ 2 奈米製程 high pin count (>70000) MEMS probe card

■ Non-skip die multi-DUT AP probe card

■ Multi-site hybrid MEMS probe card/load board IC 測試介面載板

C.將朝產品及技術垂直整合方向前進。

(2)預計投入研發費用：

本公司 112 年及 113 年度之研發費用占各年度營收比重分別為 12%及 14%，因全球半導體產業景氣逐漸復甦，致研發投入金額從 112 年的 166,118 仟元增加到 113 年的 248,474 仟元，增加幅度 50%。預計以後年度應會投入同樣水準的研發支出金額，以維持本公司競爭優勢。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運活動均遵循國內外現行相關法令規範，各相關業管人員亦隨時注意法令變動之情形，且提出即時資訊供公司管理階層參考，因而國內外重要政策及法律變動，本公司均能即時掌握並有效因應。從 108 年起中美貿易爭議的持續演變，全球所有半導體產業均產生不小的影響，本公司會隨時注意相關趨勢，適時調整營運架構。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無因國內外政策及法令變動而對財務與業務產生重大不利影響之情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司處於半導體測試產業鏈中，提供晶圓 IC 測試載板及服務等，本公司隨時注意相關產業之技術發展趨勢，在新技術發展初期，本公司即與客戶一同研發新的測試技術、電路布局規劃、開發新的測試板材、機構組件、貼合技術等，同時管理階層亦充分掌握未來市場方向並適時調整技術開發策略，以降低科技或產業變化對本公司造成之影響。最近年度及截至年報刊印日止，科技改變、資通安全風險及產業之變化對本公司財務及業務並未有重大之影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來一直致力維護公司形象，並秉持誠信、穩健之經營理念從事商業活動，且未來正朝向強化公司治理方面前進。最近年度及截至年報刊印日止，本公

司尚無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司目前無任何併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司 107 年 1 月以前之營業登記場係為租賃場所。鑒於公司永續發展及因應營收規模擴大而產生自建廠房的需求，故於 105 年 2 月向新竹縣政府標得工業地一筆(竹北莊敬段 725 號，基地面積：1449.98m²)，並於同年 12 月開始興建總部廠辦大樓(地上 5 層、地下 3 層、總樓板面積：6126.88m²)，已於 107 年 2 月陸續遷入新廠址開始營運。

基於公司長期營運所需及擴充產能需要，董事會於 113 年 3 月 15 日通過購置新土地及廠房案，交易總金額 433,750 仟元，取得土地面積 1,511.83 平方公尺(折合約 457.33 坪)及建物面積 6,197.52 平方公尺(折合約 1,874.93 坪)。將整合各分散辦公室人員，使整體營運管理溝通將更有效率，除直接節省租金支出及增加同仁的凝聚力與向心力外，公司也會取得較大生產空間，有利於未來新產品線的產能規劃，使擴充廠房產生之風險降到最低。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施：

半導體測試載板主要原料為印刷電路板(PCB, Print Circuit Board)、金屬框架(Stiffener)、繼電器(Relay)、線材等材料，這些進貨原料本公司均有超過兩家以上的供應商，依據市場供貨狀態及客戶季節性訂單需求等，透過詢比議價及交期需求調整其進貨比例。對於原料供應商的選擇，係以產品之品質、可靠度、穩定度及安全性為考量，以符合客戶要求。而本公司對原料及其供應商訂定相關審核及管理辦法，因此在品質及供貨條件皆可符合本公司需求。以此管理模式及運作可確保穩定供貨，加上主要原料都已開發二家以上合格供應商，因此應可有效降低原料進貨來源過度集中風險。故截至目前為止供貨情況良好，並未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情事。

2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司 113 年無占 10%總銷貨百分比以上的客戶，本公司的主要客戶為台灣及亞洲地區的 IC 測試產業及 IC 設計客戶。未來重心將持續投入研發資源，開發新產品及提供新的測試解決方案服務，並與產業界中重要的測試零組件探測頭、探測針、Substrate 供應商策略合作，提供多元的產品線組合和服務提供客戶選擇。除維持已有良好合作的既有客戶外，也積極拓展海外新客戶，以避免過度集中單一市場或客戶所造成的潛在風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情形而對公司本公司之經營營運產生風險。

(十二)其他重要風險及因應措施：無。

(十三)訴訟或非訟事件：

- 1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
- 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- 3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

七、其他重要事項

有關本公司針對關鍵技術的掌握暨營業秘密保護之具體措施，係透過執行本公司內部控制制度程序來達成目標，避免本公司關鍵技術文件及重要機密資料外流，以下分別依照文件及資料的控管、人員接觸權限之控管及網路系統及程式等控管三個層面說明：

(一)文件及資料的控管：

- 1.依本公司「電腦化資訊系統管制制度」中的「檔案及設備安全控制作業」中規定，公司機密資料或檔案應予以做權限控管或是加密保護，避免公司內部無相關權限之人可以取得機密資料。
- 2.依本公司「研發循環」中的「研發技術及文件保管」中規定，本公司各階段產出之技術工程文件列為機密文件，由專案負責人負責相關文件變更之管理；專案量產後對於文件之變更，依「文件及資料管理辦法」規定執行。機密文件之控管及後續變更程序，均須經權責主管核准方可進行。

(二)人員接觸權限之控管：

- 1.依本公司「電腦化資訊系統管制制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規定，資訊單位人員對因職務或業務而知悉或持有本公司科技與業務機密應負有保密義務。
- 2.依本公司「電腦化資訊系統管制制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規定，對於公司外部人員，例如委外人員之電腦通行使用權利應經適當控管，委外期間結束後，應立即收回該項權利。

(三)網路系統及程式之控管：

- 1.依本公司「電腦化資訊系統管理制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規定，本公司應於資訊系統設置防火牆及防毒軟體等相關安全設定，以防止駭客或電腦病毒之侵害。本公司資訊人員亦定期檢視防火牆運作情形。

- 2.依本公司「電腦化資訊系統管理制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規定，委外作業應簽訂契約，並於契約內容規範須符合公司資訊安全政策及法律要求。
- 3.本公司有網路資安監控相關軟體，針對公司重要資料或是研發資料庫之所有異動及存取有相關的紀錄，可以追蹤控管。

透過上述文件及資料的控管、人員接觸權限之控管及網路系統及程式之控管等程序，落實並執行本公司內部控制制度的相關規定，避免本公司關鍵技術暨營業秘密的機密資料或文件遭竊取或外流，以保護本公司之重要資產及維持競爭力。

本公司聘僱契約第五條亦明訂保密義務相關規範，在員工於雙方僱傭關係結束後，仍負有保護營業秘密之義務，離職員工對於因職務之需要而知悉或持有本公司之營業秘密，非經本公司事前書面同意，離職員工不得以口頭、影印、借閱、交付、文章發表或以其他任何方法，洩露於合作廠商、競爭者或其它第三人以及本公司業務不相關之員工。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

公開資訊觀測站→單一公司→電子文件下載→關係企業三書表專區(公司代號:6683)查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

雍智科技股份有限公司



負責人：李職民

